

CDC6Cx 低消費電力、LVCMOS 出力の BAW 発振器

1 特長

- 250kHz ~ 200MHz の周波数範囲をサポートする LVCMOS 出力発振回路
- すべての要因と 10 年の経年劣化を含め $\pm 25\text{ppm}$ の総合的な周波数安定性
- 電源電圧は 1.8V ~ 3.3V $\pm 10\%$ です。
- 超低消費電力 1.8V で 25MHz のとき標準値 4.32mA、最大値 7.4mA
- 1.8V でのスタンバイ電流の標準値 1.5 μA は、バッテリー駆動アプリケーションに有用
- 低ジッタ: $F_{\text{OUT}} \geq 10\text{MHz}$ のときジッターは 1ps RMS 未満
- 最小の業界標準パッケージ 1.60mm × 1.2mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLX)、2.50mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLE)
 - メカニカル、パッケージ、および注文情報での汎用ランドパターンフットプリント
- 動作温度範囲: -40°C ~ $+105^{\circ}\text{C}$
- 内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現
- 起動時間 3ms 未満
 - 他の起動時間については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
- EMI を低減するため、低速の立ち上がりおよび時間と立ち下がり時間のオプションを注文可能
- サポートされている周波数 (MHz):
 - 1.2、2.048、4、5.12、6.78、8、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、24、24.576、25、26、27、30、33.33、33.333、38.4、40、48、50、66.666、76.8、100、125、156.25 他
- 周波数とサンプルが必要な場合は、テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください。

2 アプリケーション

- 水晶発振器の代替
- データセンター、サーバー、ストレージ
- イーサネット、SAS、SATA、USB、Wi-Fi
- ワイヤレス通信
- 業務用オーディオ / ビデオ
- ファクトリオートメーション / 制御
- パーソナルエレクトロニクス、ウェアラブルデバイス、IoT
- FPGA、MCU、プロセッサ、ASIC クロッキング

3 説明

テキサス・インスツルメンツの高精度バルク弾性波 (BAW) マイクロ共振器技術がパッケージに直接統合されているため、低ジッタのクロック回路を実現できます。BAW は、シリコンベースのその他の製造プロセスと同様にテキサス・インスツルメンツの工場ですべてに設計および製造されています。

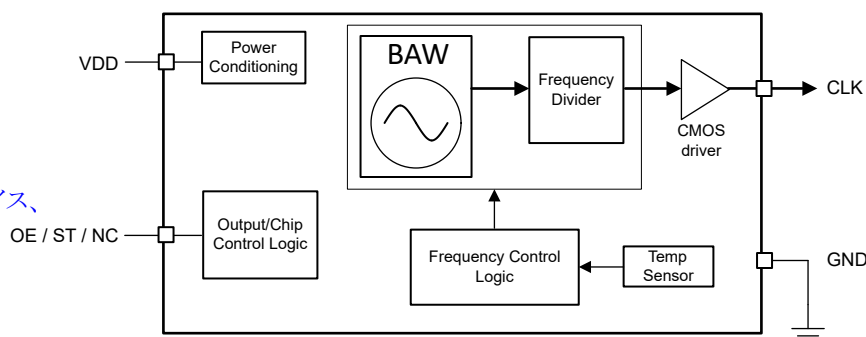
CDC6Cx デバイスは、共振器源として BAW を組み込んだ低ジッタ、低消費電力の固定周波数発振器です。本デバイスは、特定の周波数および機能ピンに合わせて工場出荷時にプログラム済みです。CDC6Cx は周波数制御ロジックと出力周波数分周器を搭載しており、仕様範囲内で任意の周波数を生成できるため、1 つのデバイスファミリであらゆる周波数のニーズに対応可能です。

このデバイスは高性能のクロックを供給し、機械的安定性があり、低消費電力で柔軟性が高く、小型パッケージのオプションもあり、産業用、テレコム、データ、およびエンタープライズネットワークやパーソナルエレクトロニクスの最終製品のリファレンスクロックやコアクロックに適しています。

パッケージ情報

部品番号	出力タイプ	パッケージ (1)	パッケージサイズ (2)
CDC6Cx	LVCMOS	VSON (DLE-4)	3.20mm × 2.50mm
		VSON (DLF-4)	2.50mm × 2.00mm
		VSON (DLX-4)	2.00mm × 1.60mm
		VSON (DLY-4)	1.60mm × 1.20mm

- 詳細については、メカニカル、パッケージ、および注文情報を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



CDC6Cx の概略ブロック図



目次

1 特長.....	1	8.2 機能ブロック図.....	15
2 アプリケーション.....	1	8.3 機能説明.....	15
3 説明.....	1	8.4 デバイスの機能モード.....	20
4 デバイスの比較.....	3	9 アプリケーションと実装.....	21
5 ピン構成および機能.....	4	9.1 アプリケーション情報.....	21
6 仕様.....	5	9.2 代表的なアプリケーション.....	21
6.1 絶対最大定格.....	5	9.3 電源に関する推奨事項.....	26
6.2 ESD 定格.....	5	9.4 レイアウト.....	27
6.3 環境関連法令順守.....	5	10 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	33
6.4 推奨動作条件.....	5	10.1 ドキュメントのサポート.....	33
6.5 熱に関する情報.....	6	10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	33
6.6 電気的特性.....	6	10.3 サポート・リソース.....	33
6.7 タイミング図.....	9	10.4 商標.....	33
6.8 代表的特性.....	11	10.5 静電気放電に関する注意事項.....	33
7 パラメータ測定情報.....	14	10.6 用語集.....	33
7.1 デバイス出力構成.....	14	11 改訂履歴.....	33
8 詳細説明.....	15	12 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	36
8.1 概要.....	15		

4 デバイスの比較

『CDC6C OPN デコーダ』を使用して、CDC6Cx の注文可能なオプションの命名規則をご確認ください。『CDC6C OPN デコーダ』では、周波数、パッケージ情報、CDC6Cx の注文可能な型番 (OPN) リスト、関連する構成、パッケージ情報、デバイス上面のマーキングの読み取り方を説明しています。

セクション 8.3.5.1 では標準モードと低速モードのさまざまなオプションについて説明し、セクション 8.3.3 ではスタンバイと出力イネーブル オプションについて説明しています。

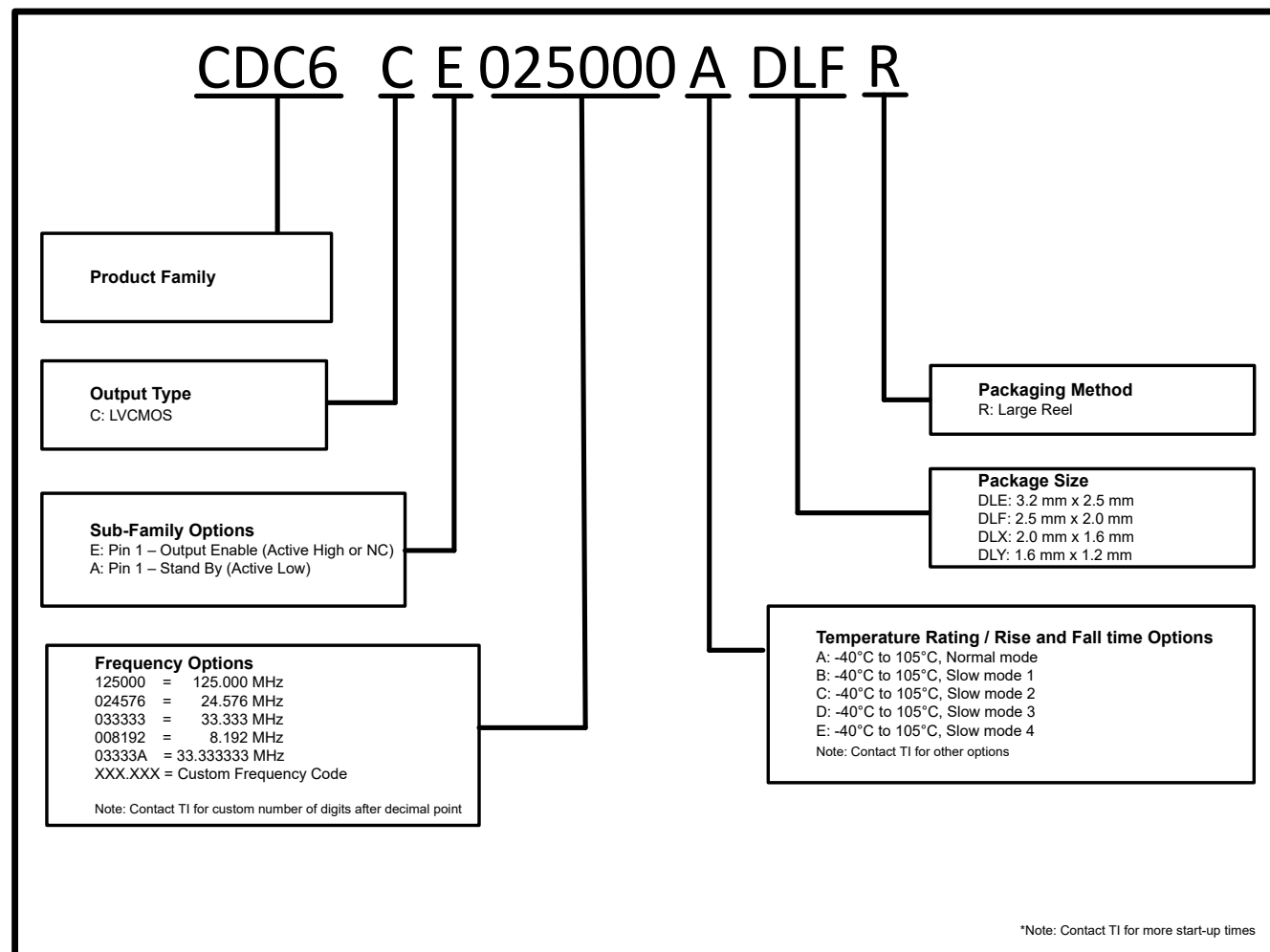


図 4-1. 型番ガイド : CDC6Cx

注: 特定のデバイスを事前注文される場合は、テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください。Email: ti_osc_customer_requirement@list.ti.com

5 ピン構成および機能

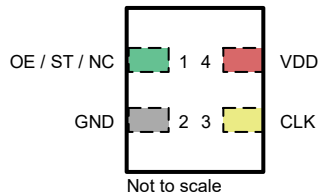


図 5-1. CDC6Cx 4 ピン VSON (上面図)

凡例	
入力	電源
グランド	出力

表 5-1. CDC6Cx のピンの機能

ピン		種類 ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
OE/ST/NC	1	I/NC	出力イネーブル (OE) またはスタンバイ (ST) ピンまたは未接続 (NC)。詳細については、「機能ピンの説明」を参照してください。
GND	2	G	デバイスのグランド
CLK	3	O	LVC MOS 出力クロック
VDD	4	P	デバイス電源

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源、NC = 未接続 (フローティングのままとしても可)。

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲超 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V _{DD}	デバイス電源電圧 ⁽²⁾	-0.3	3.63	V
EN	ロジック入力電圧	-0.3	3.63	V
CLK	クロック出力電圧	-0.3	3.63	V
T _J	接合部温度		130	°C
T _{STG}	保存温度	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 推奨動作電圧が 1.8V±10%、2.5V±10%、および 3.3V±10% のすべてのデバイスについて

6.2 ESD 定格

			値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002、HBM ESD 分類レベル 2 準拠	±2000	V
V _(ESD)	静電放電	デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 CDM ESD 分類レベル C4A 準拠	±750	V

6.3 環境関連法令順守

		値	単位
機械的振動抵抗	MIL-STD-883F、メソッド 2026 条件 C	10	g
機械的振動抵抗	MIL-STD-883F、メソッド 2007 条件 A	20	g
機械的衝撃抵抗	MIL-STD-883F、メソッド 2002 条件 A	1500	g
耐湿性レベル(MSL)		MSL1	

6.4 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
V _{DD}	デバイス電源電圧 ⁽¹⁾	1.62	1.8、2.5、3.3	3.63	V
T _A	周囲温度	-40		105	°C
T _J	接合部温度			130	°C
t _{RAMP}	V _{DD} パワーアップ ランプ時間 ⁽²⁾	0.1		100	ms

- (1) 推奨動作電圧が 1.8V±10%、2.5V±10%、および 3.3V±10% のすべてのデバイスについて
- (2) V_{DD} パワーアップ ランプ時間は、電源が公称 VDD の 95%を超えるまでの最小時間として定義されます。単調な電源ランプを想定しています。

6.5 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		CDC6C				単位
		DLE	DLF	DLX	DLY	
		4	4	4	4	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	151.8	151.7	180.3	189.1	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	89.5	99.3	116.2	137.3	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	72.2	64.4	85.5	85	°C/W
Ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	11.1	9.2	8.5	6.2	°C/W
Ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	71.2	63.5	83.7	83.2	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

6.6 電気的特性

推奨動作条件全体にわたる (V_{DD} = 1.8V±10%、2.5V±10%、3.3V±10%、特に記述のない限り、標準値は 25°C のときの値)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
消費電流特性						
I _{DD}	デバイスの消費電流 (負荷電流を除く)	−40°C ~ 85°C, F _{out} = 20MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	4.22	6.7		mA
		−40°C ~ 85°C, F _{out} = 20MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	4.41	6.7		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 20MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	4.22	7.3		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 20MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	4.41	7.3		mA
I _{DD}	デバイスの消費電流 (負荷電流を除く)	−40°C ~ 85°C, F _{out} = 25MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	4.32	6.8		mA
		−40°C ~ 85°C, F _{out} = 25MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	4.57	6.9		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 25MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	4.32	7.4		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 25MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	4.57	7.5		mA
I _{DD}	デバイスの消費電流 (負荷電流を除く)	−40°C ~ 85°C, F _{out} = 50MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	4.84	7.1		mA
		−40°C ~ 85°C, F _{out} = 50MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	5.33	7.2		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 50MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	4.84	7.6		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 50MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	5.33	7.8		mA
I _{DD}	デバイスの消費電流 (負荷電流を除く)	−40°C ~ 85°C, F _{out} = 100MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	5.86	7.6		mA
		−40°C ~ 85°C, F _{out} = 100MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	6.77	9.0		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 100MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	5.86	8.2		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 100MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	6.77	9.0		mA
I _{DD}	デバイスの消費電流 (負荷電流を除く)	−40°C ~ 85°C, F _{out} = 150MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	7.14	9.5		mA
		−40°C ~ 85°C, F _{out} = 150MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	8.72	11.0		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 150MHz, V _{dd} = 1.8V±10%	7.14	9.5		mA
		−40°C ~ 105°C, F _{out} = 150MHz, V _{dd} = 3.3V±10%	8.72	11.0		mA
I _{DD_stdby}	デバイスのスタンバイ電流	−40°C ~ 85°C, ST = GND, V _{dd} = 1.8V±10%	1.5			μA
		−40°C ~ 85°C, ST = GND, V _{dd} = 2.5V±10%	2			μA
		−40°C ~ 85°C, ST = GND, V _{dd} = 3.3V±10%	2.7			μA
		−40°C ~ 105°C, ST = GND, V _{dd} = 1.8V±10%	1.5			μA
		−40°C ~ 105°C, ST = GND, V _{dd} = 2.5V±10%	2			μA
		−40°C ~ 105°C, ST = GND, V _{dd} = 3.3V±10%	2.7			μA

6.6 電気的特性 (続き)

推奨動作条件全体にわたる ($V_{DD} = 1.8V \pm 10\%$, $2.5V \pm 10\%$, $3.3V \pm 10\%$, 特に記述のない限り、標準値は $25^{\circ}C$ のときの値)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
I _{DD-OD}	出力がディスエーブルのデバイス電流	−40℃ ∼ 85℃、F _{out} = 25MHz、V _{dd} = 1.8V±10%	3.75	6.4		mA
		−40℃ ∼ 85℃、F _{out} = 25MHz、V _{dd} = 3.3V±10%	3.76	6.5		mA
		−40℃ ∼ 105℃、F _{out} = 25MHz、V _{dd} = 1.8V±10%	3.75	7		mA
		−40℃ ∼ 105℃、F _{out} = 25MHz、V _{dd} = 3.3V±10%	3.76	7.1		mA
出力特性						
F _{out}	出力周波数		0.25		200	MHz
V _{OL}	出力 LOW 電圧	I _{OL} = 3.6mA、V _{DD} = 1.8V			0.36	V
		I _{OL} = 5.0mA、V _{DD} = 2.5V			0.5	V
		I _{OL} = 6.6mA、V _{DD} = 3.3V			0.66	V
V _{OH}	出力 HIGH 電圧	I _{OH} = 3.6mA、V _{DD} = 1.8V	V _{DD} × 0.88			V
		I _{OH} = 5.0mA、V _{DD} = 2.5V	V _{DD} × 0.85			V
		I _{OH} = 6.6mA、V _{DD} = 3.3V	V _{DD} × 0.85			V
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 20% ∼ 80%、C _L = 2pF、通常モード、F _{out} = 25MHz	0.28	0.65		ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 20% ∼ 80%、C _L = 2pF、低速モード 1、F _{out} = 25MHz	0.42	0.75		ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 20% ∼ 80%、C _L = 5pF、通常モード、F _{out} = 25MHz	0.33	0.8		ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 20% ∼ 80%、C _L = 5pF、低速モード 2、F _{out} = 25MHz	1.11	2.0		ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 20% ∼ 80%、C _L = 10pF、通常モード、F _{out} = 25MHz	0.44	1.7		ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 20% ∼ 80%、C _L = 10pF、低速モード 3、F _{out} = 25MHz	1.85	3.1		ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 20% ∼ 80%、C _L = 15pF、通常モード、F _{out} = 25MHz	0.87	2.2		ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 20% ∼ 80%、C _L = 15pF、低速モード 4、F _{out} = 25MHz	2.7	4.0		ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} -V _{OL} の 10% ∼ 90%、無負荷、通常モード、F _{out} = 25MHz	0.42			ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 10% ∼ 90%、C _L = 15pF、通常モード、F _{out} = 25MHz	2.05			ns
t _R /t _F	出力立ち上がり / 立ち下がり時間	V _{OH} - V _{OL} の 10% ∼ 90%、C _L = 15pF、低速モード 4、F _{out} = 25MHz	3.81			ns
ODC	出力デューティ サイクル		45	50	55	%
PN-Floor	出力位相ノイズフロア (f _{OFFSET} > 10MHz)	F _{OUT} = 50MHz		-155		dBc/Hz
C _L	最大容量性負荷	F _{OUT} = 50MHz			30	pF
C _L		F _{OUT} = 50MHz			15	pF
R _{out-high}	出力インピーダンス			50		Ω
機能ピンの特性 (OE/ST)						
V _{IL}	入力 Low 電圧	V _{DD} = 1.8V			0.45	V
		V _{DD} = 2.5V			0.475	V
		V _{DD} = 3.3V			0.5	V

6.6 電気的特性 (続き)

推奨動作条件全体にわたる ($V_{DD} = 1.8V \pm 10\%$ 、 $2.5V \pm 10\%$ 、 $3.3V \pm 10\%$ 、特に記述のない限り、標準値は 25°C のときの値)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
V _{IH}	入力 High 電圧		1.3			V
I _{IL}	入力 Low 電流	EN = GND	-70			μA
I _{IH}	高入力電流	EN = VDD			40	μA
C _{IN}	入力容量 ⁽¹⁾			2		pF
周波数の許容誤差						
F _T	総合的な周波数安定性	はんだシフト、初期公差、−40℃ ～ 105℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 10 年間の経年変化を含みます。		±25		ppm
F _T	総合的な周波数安定性	はんだシフト、初期公差、−40℃ ～ 105℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 1 年目の経年変化を含みます。		±20		ppm
F _T	総合的な周波数安定性	はんだシフト、初期公差、−40℃ ～ 85℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 10 年間の経年変化を含みます。		±25		ppm
F _T	総合的な周波数安定性	はんだシフト、初期公差、−40℃ ～ 85℃ にわたる変動、供給電圧範囲における変動、25℃ での 1 年目の経年変化を含みます。		±20		ppm
PSRR の特性						
PSRR	50MHz 出力において 50mV の電源リップルにより誘導されるスプリアス、VDD = 2.5V/3.3V、電源デカップリング コンデンサなし	50 kHz の正弦波		-80		dBc
		100 kHz の正弦波		-75		dBc
		500 kHz の正弦波		-63		dBc
		1 MHz の正弦波		-59		dBc
パワーオン特性						
t _{START_UP}	起動時間	0.95 × VDD から出力がイネーブルになり、仕様範囲内になるまでの経過時間。OE / ST = High。電源ランプ時間 200μs でテスト済み		1.5	3	ms
t _{ST-EN}	チップのイネーブル時間	スタンバイ (ST = V _{IH}) から出力がイネーブルになり、仕様範囲内になるまでの経過時間			3	ms
t _{ST-DIS}	チップのディスエーブル時間	スタンバイ (ST = V _{IL}) からチップがスタンバイ モードになるまでの経過時間			250	ns
t _{OE-EN}	出力イネーブル時間	OE = V _{IH} から出力がイネーブルになり、仕様範囲内になるまでの経過時間。			250	ns
t _{OE-DIS}	出力ディスエーブル時間	OE = V _{IL} から出力がディスエーブルになるまでの経過時間			250	ns
クロック出力ジッタ						
R _J	ランダム位相ジッタ	10MHz ≤ F _{out} ≤ 40MHz (25MHz を除く)、積分 BW: 12kHz ～ 5MHz、最大温度 = 105℃		400	1000	fs
R _J	ランダム位相ジッタ	F _{out} = 25 MHz、積分 BW: 12kHz ～ 20MHz、最大温度 = 105℃		400	1000	fs
R _J	ランダム位相ジッタ	40MHz < F _{out} ≤ 200MHz、積分 BW: 12kHz ～ 20MHz、最大温度 = 105℃		400	1000	fs
SPN _{100k}	1kHz オフセットでのスポット位相ノイズ	F _{out} = 100 MHz		-86		dBc/Hz
SPN _{100k}	10kHz オフセットでのスポット位相ノイズ	F _{out} = 100 MHz		-120		dBc/Hz
SPN _{100k}	100kHz オフセットでのスポット位相ノイズ	F _{out} = 100 MHz		-138		dBc/Hz
SPN _{1M}	1MHz オフセットでのスポット位相ノイズ	F _{out} = 100 MHz		-143		dBc/Hz

6.6 電気的特性 (続き)

推奨動作条件全体にわたる ($V_{DD} = 1.8V \pm 10\%$, $2.5V \pm 10\%$, $3.3V \pm 10\%$, 特に記述のない限り、標準値は 25°C のときの値)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
$R_{JITT, RMS}$	RMS 周期ジッタ	$F_{out} \geq 25\text{MHz}$		3		ps
$R_{JITT, PK}$	ピーク ツー ピーク 周期ジッタ	$F_{out} \geq 25\text{MHz}$		26		ps

(1) 設計で実証済み。特徴付けなし

6.7 タイミング図

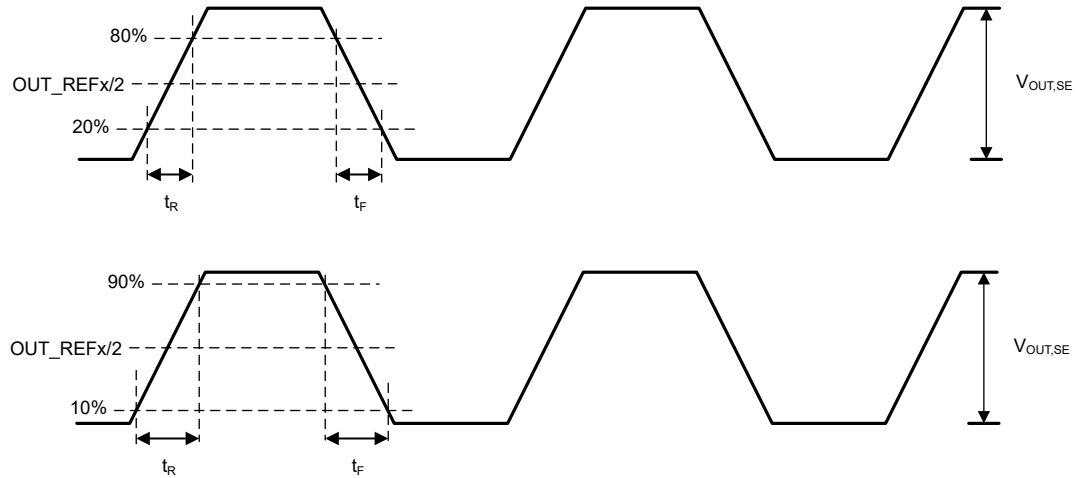


図 6-1. シングルエンド出力電圧と立ち上がり / 立ち下がり時間

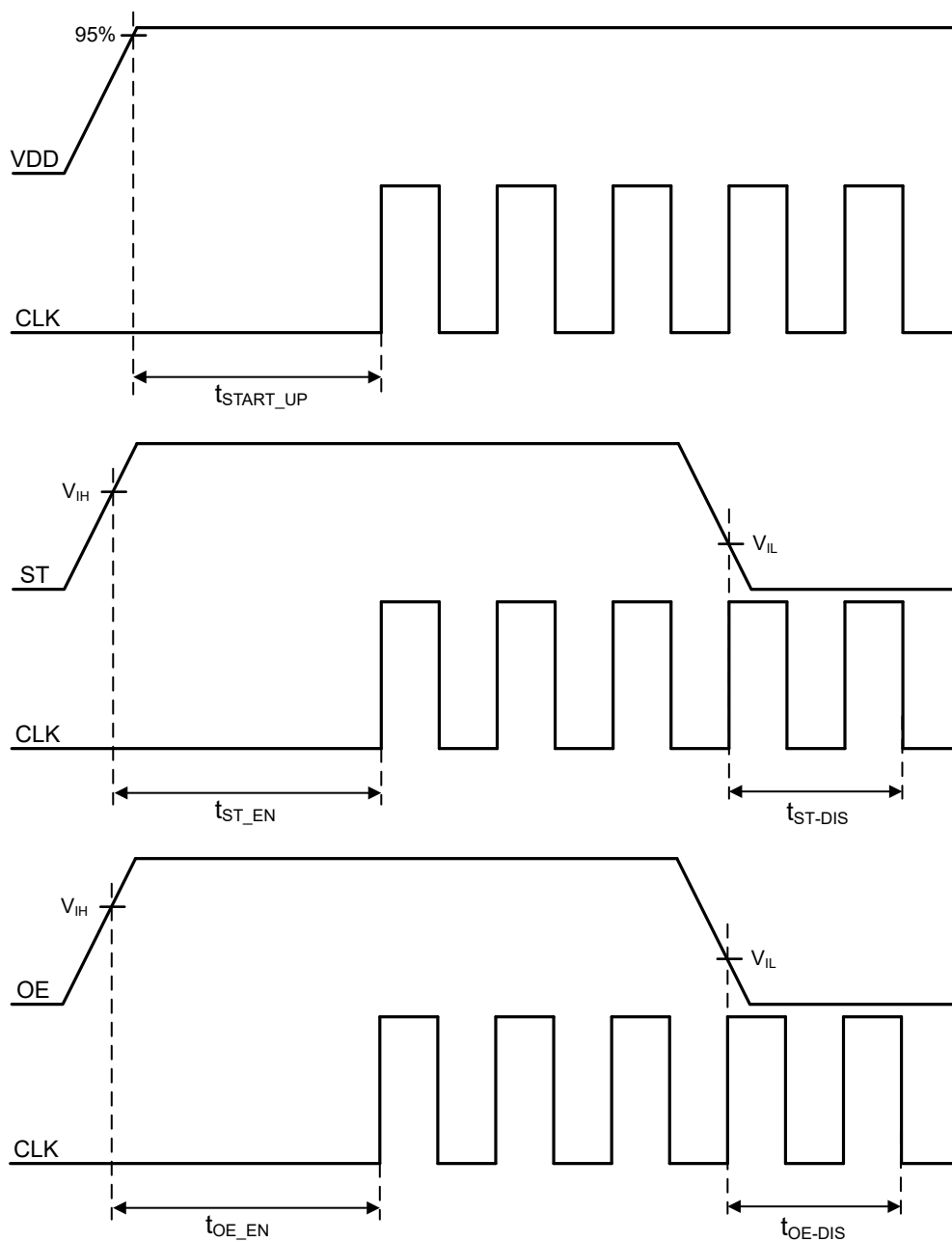


図 6-2. パワーオン特性

6.8 代表的特性

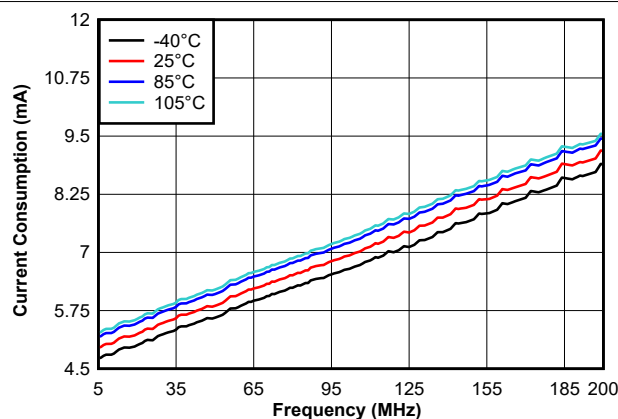


図 6-3. 1.8V 電源での消費電流と周波数および温度との関係

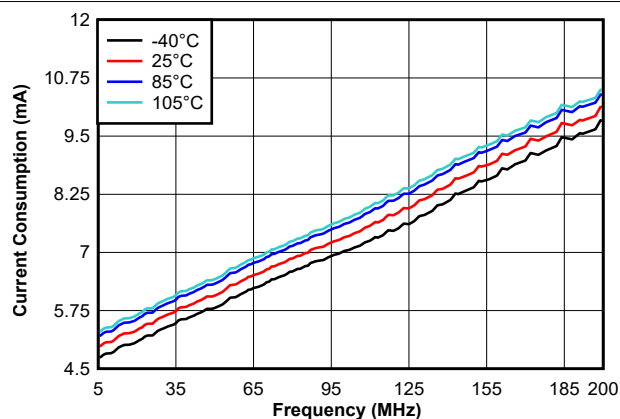


図 6-4. 2.5V 電源での消費電流と周波数および温度との関係

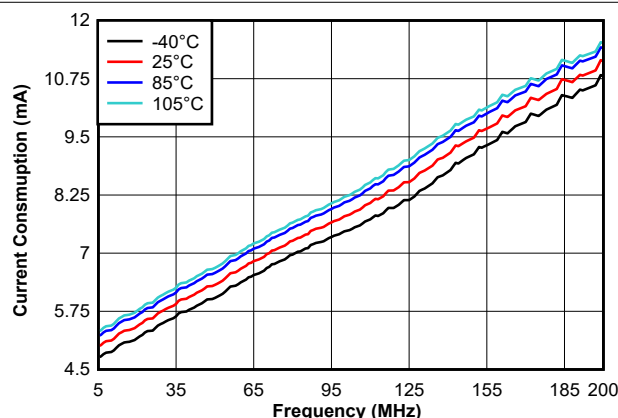


図 6-5. 3.3V 電源での消費電流と周波数および温度との関係

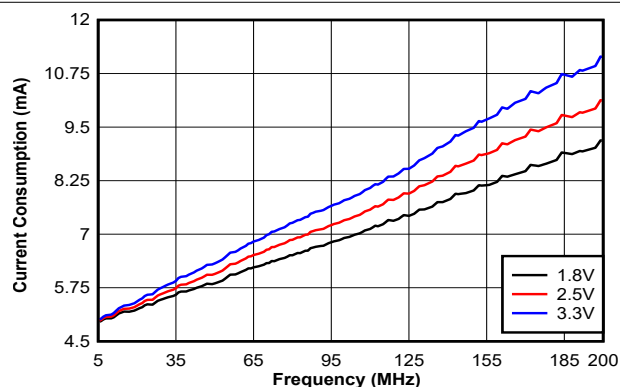


図 6-6. 25°C での消費電流と周波数および電源電圧との関係

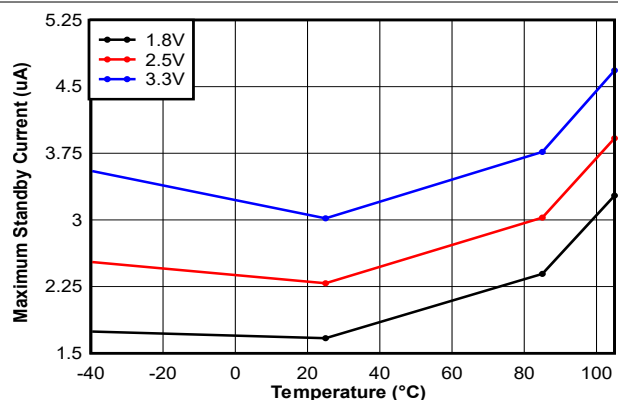


図 6-7. スタンバイ電流の最大値と温度および電源電圧との関係

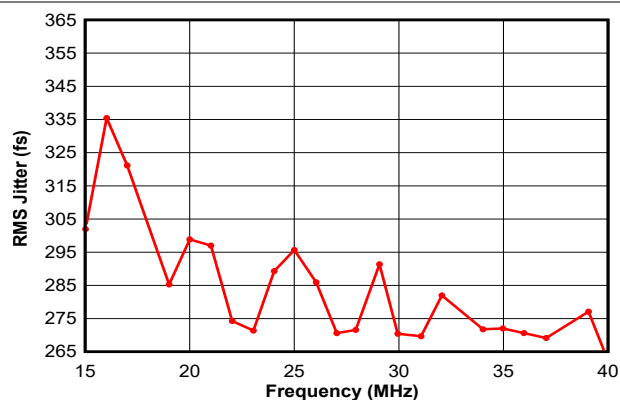


図 6-8. 3.3V 電源および 25°C での標準的なジッタ RMS と周波数との関係 (BW 12kHz ~ 5MHz)

6.8 代表的特性 (続き)

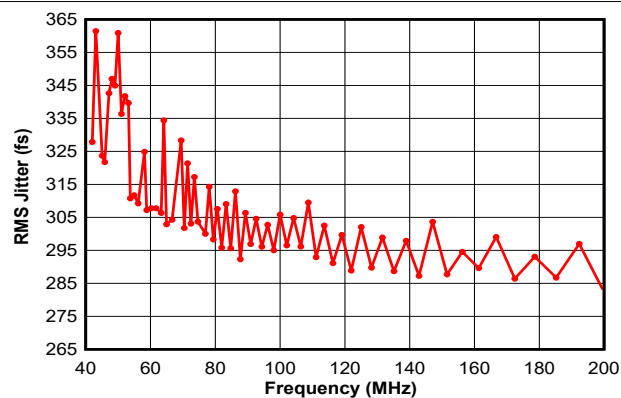


図 6-9. 3.3V 電源および 25°C での標準的なジッタ RMS と周波数との関係 (BW 12kHz ~ 20MHz)

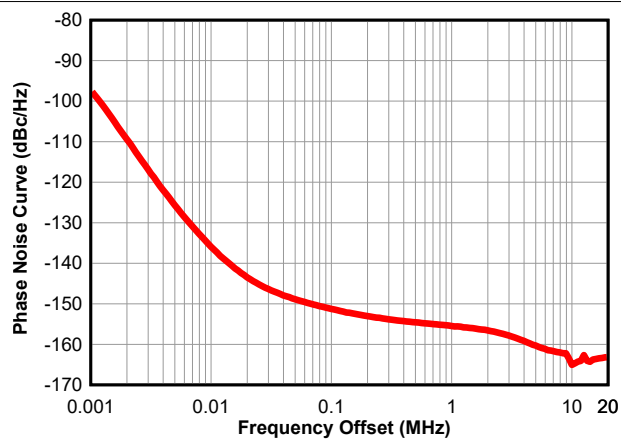


図 6-10. 25MHz、25°C、3.3V 電源での位相ノイズ曲線

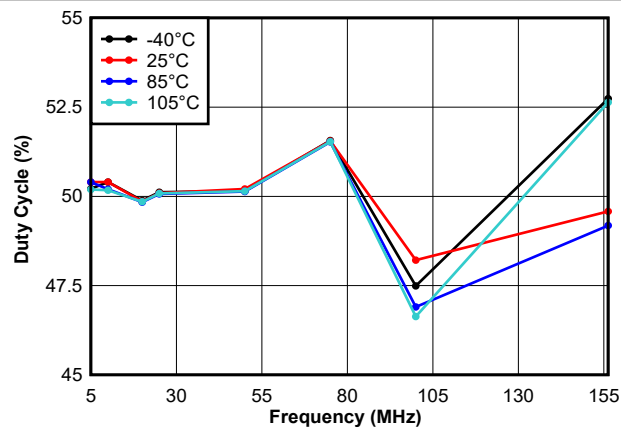


図 6-11. デューティ サイクルと周波数および温度との関係 (3.3V 電源、容量性負荷なし、通常モードのデバイス)

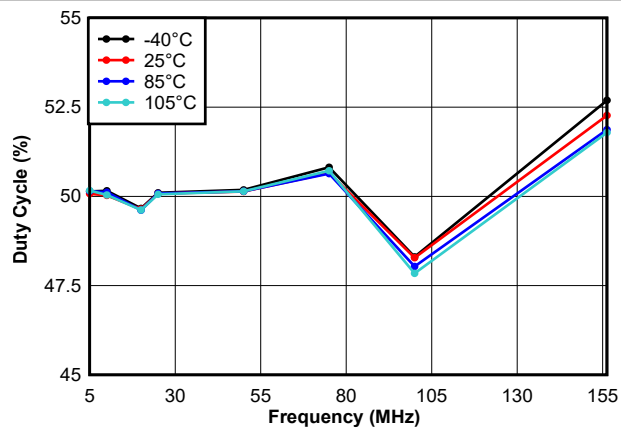


図 6-12. デューティ サイクルと周波数および温度との関係 (2.5V 電源、容量性負荷なし、通常モードのデバイス)

6.8 代表的特性 (続き)

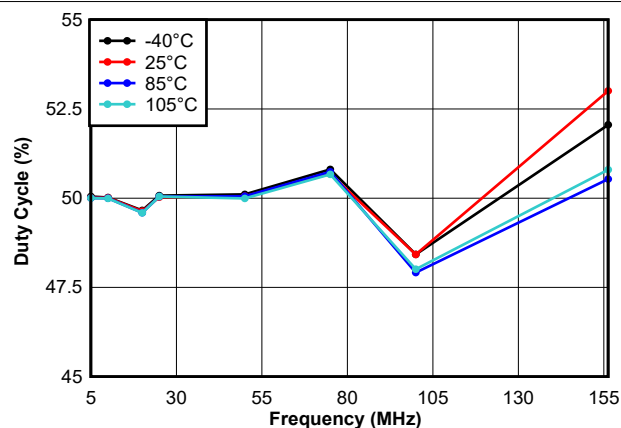


図 6-13. デューティ サイクルと周波数および温度との関係 (1.8V 電源、容量性負荷なし、通常モードのデバイス)

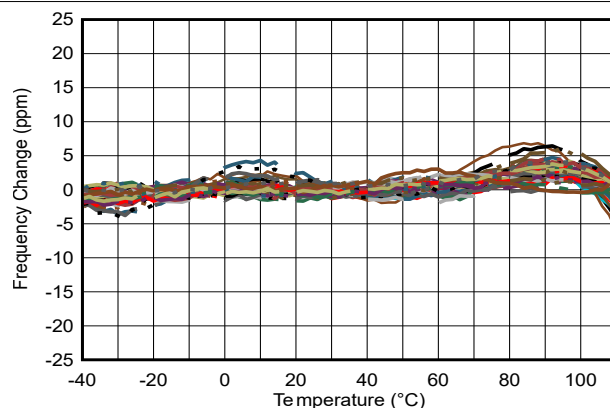
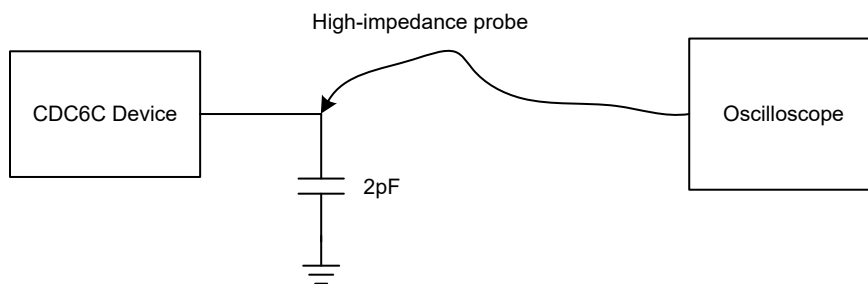


図 6-14. 周波数変化と温度との関係 (25MHz および 3.3V 電源、デバイス 80 台)

7 パラメータ測定情報

7.1 デバイス出力構成



測定条件に基づいて変更された負荷コンデンサ。

図 7-1. CDC6Cx 出力テスト構成

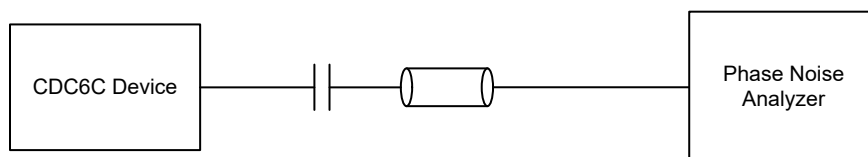


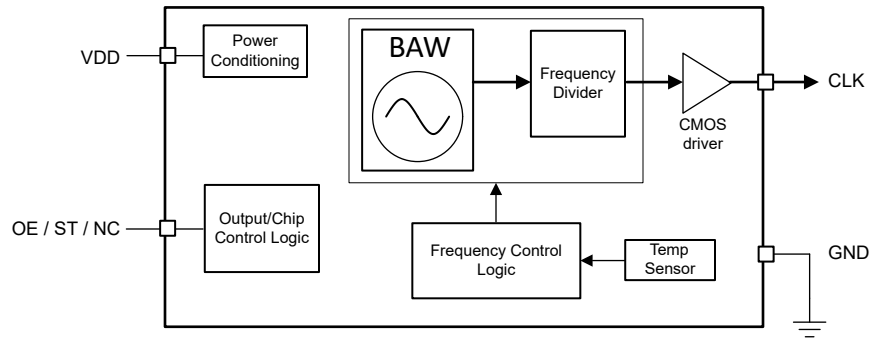
図 7-2. CDC6Cx の出力位相ノイズテスト構成

8 詳細説明

8.1 概要

CDC6Cx は、250kHz ～ 200MHz の範囲内の CMOS 出力をサポートする定周波数の BAW ベース発振器です。

8.2 機能ブロック図



8.3 機能説明

8.3.1 バルク弾性波 (BAW)

テキサス・インスツルメンツの BAW 共振器テクノロジーは、2.5GHz で高 Q 共振を発生させるために圧電変換を利用しています。この共振器は、上下の電極に挟まれた四角形の領域によって定義されます。高音響インピーダンス層と低音響インピーダンス層を交互に配置することで、共振体の下に音響ミラーを形成し、基板への音響エネルギーの漏れを防止します。さらに、デバイスを汚染から保護し、パッケージ材料へのエネルギーの漏れを最小限に抑えるため、これらの音響ミラーは共振器スタックの上に配置されています。この独自のデュアル ブラッグ音響共振器 (DBAR) によって、共振器を囲む高価な真空キャビティがなくても効果的に励起することを可能にしています。その結果、テキサス・インスツルメンツの BAW 共振器は、表面汚染物質の吸収による周波数ドリフトの影響を受けず、小型の標準的な発振器の非気密プラスチックパッケージ内に発振器 IC と共に直接配置できます。

8.3.2 デバイス ブロック レベルの説明

このデバイスは、BAW 発振器、周波数整数分周器、CMOS ドライバを内蔵しており、これらを組み合わせることで、あらかじめ設定された出力周波数を生成します。発振周波数の温度変動は、内部の高精度温度センサによって連続的に監視され、その信号は周波数制御ロジックブロックに入力されます。この周波数制御ロジックブロックを使って、温度による変動と経時変動を含めて $\pm 25\text{ppm}$ 以内に出力周波数を維持するために、周波数補正が内部的に実行されます。本デバイスは、電源ノイズを低減する LDO を内蔵しているため、低ノイズのクロック出力が得られます。

8.3.3 機能ピン

CDC6Cx のピン 1 は、注文可能な品番に基づいた複数の機能を持つ機能ピンです。この機能は、出力イネーブル (OE)、スタンバイ (ST)、または未接続 (NC) として使用できます。アクティブ High とアクティブ Low の両方のオプションを、OE と ST で使用できます。アクティブ Low オプションについては、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。「機能ピンの説明」表に、ピン 1 の機能を示します。

表 8-1. CDC6Cx の機能ピンの説明

注文可能オプション	ピンの説明	出力機能
E (ピン 1)	出力イネーブル (アクティブ High/NC)	High または未接続: 指定された周波数で出力アクティブ LOW: 出力ディスエーブル、高インピーダンス。 消費電流は、 I_{DD-OD} により与えられます

表 8-1. CDC6Cx の機能ピンの説明 (続き)

注文可能オプション	ピンの説明	出力機能
A (ピン 1)	スタンバイ (アクティブ Low)	High または未接続: 指定された周波数で出力アクティブ LOW: ハイ インピーダンス、スタンバイ モード、消費電流はスタンバイ電流 $I_{DD-stdby}$ により得られます

スタンバイ モードでは、「電力特性」の「消費電流特性」部分に示されているスタンバイ電流と等価な最大限の消費電流の節約を行うために、すべてのブロックをパワーダウンします。出力クロックのアクティブ時間への復帰は、対応する初期起動時間と同じです。

機能ピンは、100k Ω より大きな抵抗で内部で駆動されます。

8.3.4 クロック出力のインターフェイスと終端

次の図は、推奨される出力インターフェイスと終端回路を示しています。

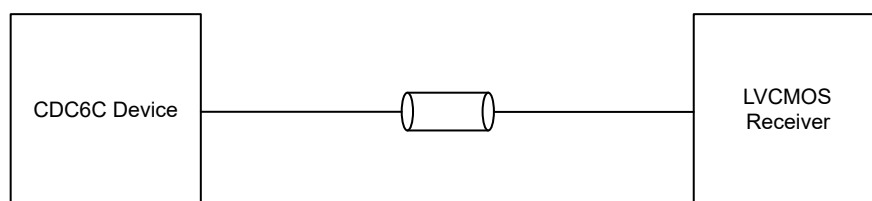


図 8-1. LVCMOS レシーバへの CDC6Cx の出力

8.3.5 CDC6Cx の CISPR25 放射エミッション性能

CDC6Cx の放射 EMI エミッション性能は、本デバイスがクラス 3 に適合する GPS L1 (1567.42MHz から 1583.42MHz) を除くすべての周波数帯で CISPR-25 クラス 5 に適合します。CDC6Cx は、5pF 端子の低速モード 2 用に構成されています。このテストでは、DLE と DLY の各パッケージで 1.8V と 3.3V の 25MHz CDC6Cx 発振器を観察しました。使用されるボードは 50mil のパターン長を備えており、最大 13GHz で動作するアンテナを使用して、CISPR-25 用のプリコンプライアンス EMI チャンバー セットアップでテストされています。詳細については、『[CDC6Cx CISPR25 放射エミッション性能レポート](#)』を参照してください。

8.3.5.1 EMI 低減および低速モード オプション

EMI を低減するため、CDC6Cx では、スルー レートを減少させて立ち上がり / 立ち下がり時間を増加させるオプションを注文できます。クロック出力の急速な立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを遅くするか、または出力スルー レートを小さくすると、高周波の高調波が減少し、EMI が低下します。EMI を抑える必要があるアプリケーションの場合、適切な立ち上がり / 立ち下がり時間のオプションを選択するとともに、『[CDC6Cx CISPR25 放射エミッション性能レポート](#)』を参照して EMI の低減を検討してください。

CDC6Cx には、通常モード以外に 4 つの低速モード オプションがあります。目的の立ち上がり / 立ち下がり時間に基づいて、適切な低速モード オプションおよび負荷容量値を選択します。表 8-2 に、各低速モードの最小推奨容量が示されています。

表 8-2. 低速モード別の最小推奨容量

スロー モード	最小推奨容量 (pF)
低速モード 1	2
低速モード 2	5
低速モード 3	10
低速モード 4	15

表 8-3 は、25MHz 出力クロックのさまざまな負荷容量に対する推奨低速モードオプションの一覧です。たとえば、負荷容量が 15pF の場合、低速モード 4 オプションを使用すると、立ち上がり / 立ち下がり時間が最もゆっくりになります。15pF で低速モード 1、低速モード 2、低速モード 3 も選択できますが、立ち上がり / 立ち下がり時間がより高速になります。

表 8-3. 立ち上がり / 立ち下がり時間のオプション (25MHz 出力)

低速モード オプション	負荷容量	低速モードでの立ち上がり / 立ち下がり時間 (ns) (標準値 / 最大値)	通常モードでの立ち上がり / 立ち下がり時間 (ns) (標準値 / 最大値)
低速モード 1	2pF	0.81 / 1.06	0.62 / 1.01
低速モード 2	5pF	1.47 / 1.62	0.76 / 1.24
低速モード 3	10pF	2.44 / 2.61	1.4 / 1.7
低速モード 4	15pF	3.29 / 3.5	1.88 / 2.11

8.3.6 温度安定性

図 8-2 に、温度に応じた CDC6Cx の周波数の変化を示します。図は、 -40°C ~ 105°C の範囲のさまざまな温度における 80 台のデバイスの周波数変化を示しています。これによると、デバイスの標準温度安定性は $\pm 10\text{ppm}$ の範囲内であることが分かります。

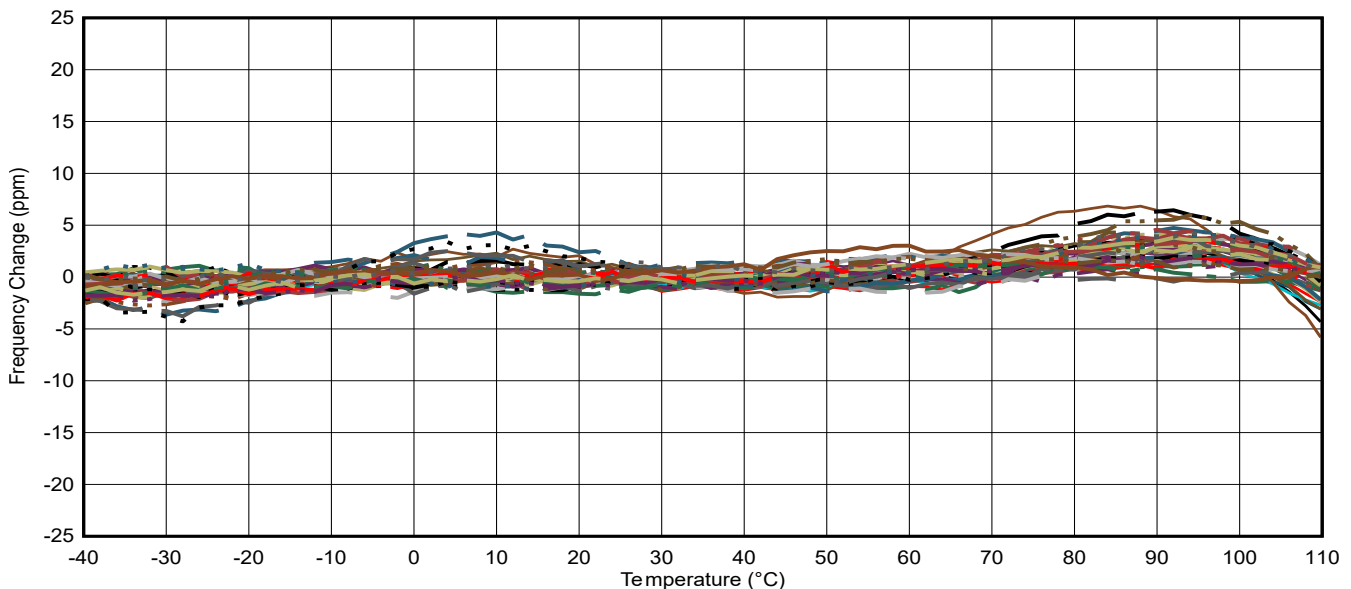


図 8-2. デバイス 80 台にわたり一連の温度で 25MHz を基準に計測したときの標準温度安定性

8.3.7 周波数の経時変化

表 8-4 は CDC6Cx の温度別経時変化後の標準的な周波数シフトです。周波数ドリフトは、各温度で 1000 時間以上測定し、MIL-PRF-55310-REV-F を使用して推定し、最長 20 年間の周波数安定性を予測します。75°C で 20 年の経時後、予測される周波数安定性は $\pm 26\text{ppm}$ です。

表 8-4. 55°C と 75°C での 20 年間の CDC6Cx の典型的な周波数経時変化

温度 (°C)	1 年経時変化 (ppm)		10 年経時変化 (ppm)		20 年経時変化 (ppm)	
	経時変化による周波数ドリフト	総合的な周波数安定性	経時変化による周波数ドリフト	総合的な周波数安定性	経時変化による周波数ドリフト	総合的な周波数安定性
55	± 2.39	± 21.43	± 3.41	± 22.62	± 3.72	± 23.5
75	± 2.58	± 21.96	± 3.92	± 24.6	± 4.33	± 25.33

8.3.8 機械的堅牢性

リファレンス発振器にとって振動と衝撃は、位相ノイズやジッタの増加、周波数シフトやスパイク、さらには共振器とパッケージの物理的損傷を引き起こす一般的な原因です。水晶振動子と比較して BAW 共振器は、その数桁小さい質量と高い周波数により、振動や衝撃に対する耐性が高くなります。これは、質量が小さいため、加速度によってデバイスに加わる力が非常に小さいことを意味します。

図 8-3 に、CDC6Cx BAW 発振器の振動性能を示します。テキサス・インスツルメンツでは、MIL-STD-883 のメソッド 2026 条件 C (10g) とメソッド 2007 条件 A (20g) に準拠したテストを行いました。このテストでは、EVM に取り付けられた CDC6Cx 発振器に対し、x、y、z 軸方向に 50Hz ~ 2kHz の範囲で 10g の加速度が印加されます。振動によるスプリアスを持つ位相ノイズパターンを Keysight E5052B を使用してキャプチャし、スプリアス電力から周波数偏差を計算します。次に、キャリア周波数に注意して周波数偏差を ppb に変換し、ppb/g に正規化します。最後に、3 つの軸すべてに沿った ppb/g の RMS の合計が、ppb/g 単位の振動感度として報告されます。振動下での CDC6Cx の性能は約 2ppb/g ですが、ほとんどの水晶発振器のベストケースは 3ppb/g であり、10ppb/g を上回る場合もあります。

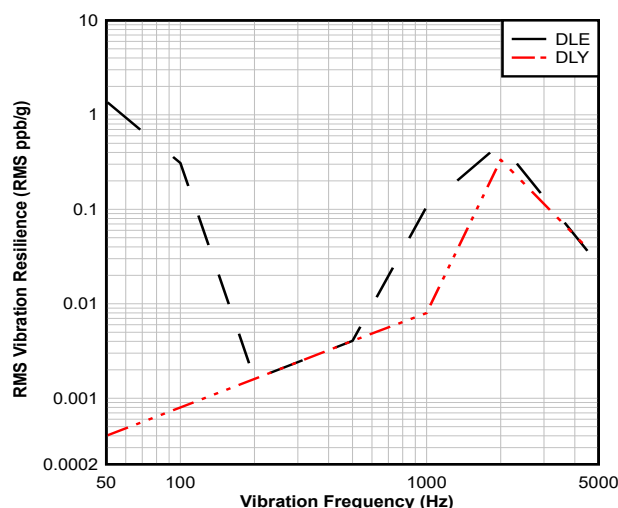


図 8-3. 振動耐性と振動周波数の関係 (25MHz、25℃、1.8V 電源—X 軸)

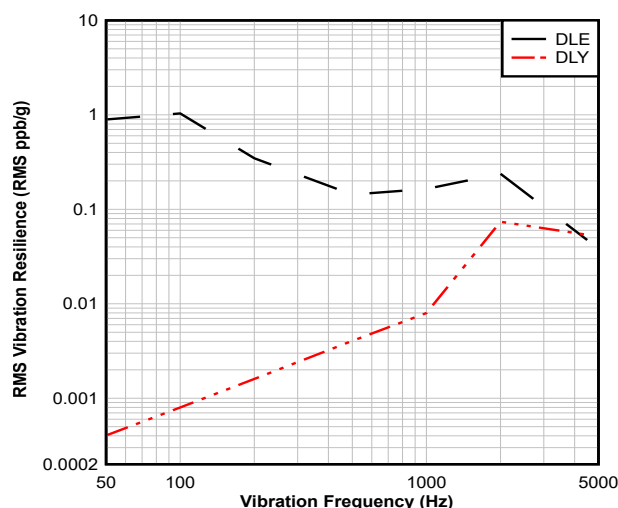


図 8-4. 振動耐性と振動周波数の関係 (25MHz、25℃、1.8V 電源—Y 軸)

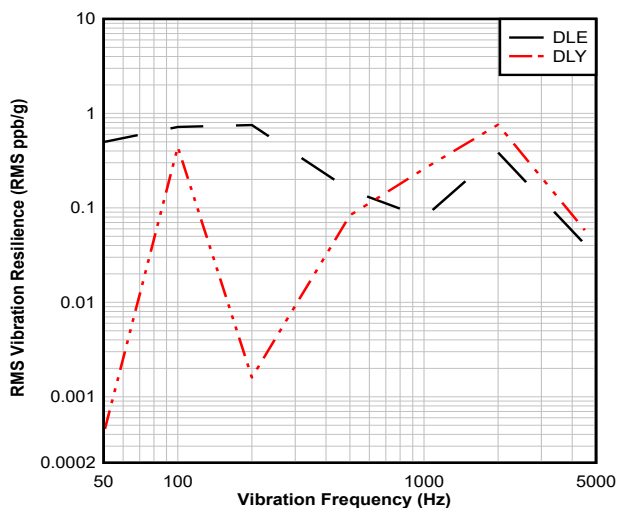


図 8-5. 振動耐性と振動周波数の関係 (25MHz、25℃、1.8V 電源—Z 軸)

テキサス・インスツルメンツでは、機械的衝撃テストでは MIL-STD-883F、メソッド 2002 条件 A (1500g) に従っています。BAW テクノロジーの機械的堅牢性の詳細については、『[水晶発振器に対するスタンドアロン BAW 発振器の利点](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

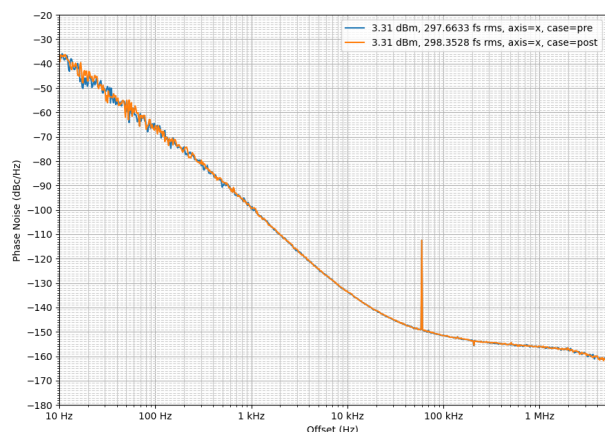


図 8-6. 1500g の前後の機械的衝撃 (25MHz および 25°C、X 軸)

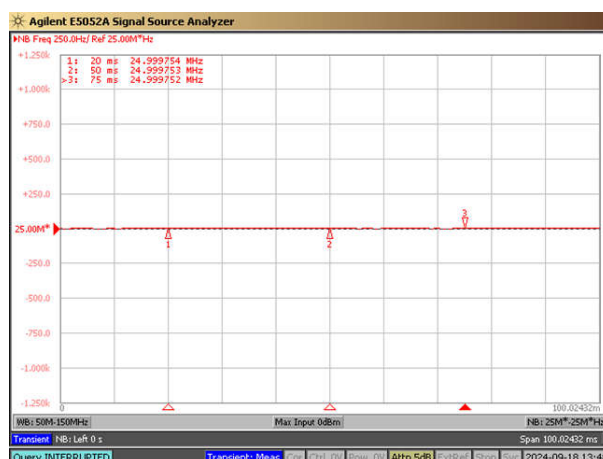


図 8-7. 1500g の間の機械的衝撃 (25MHz および 25°C、X 軸)

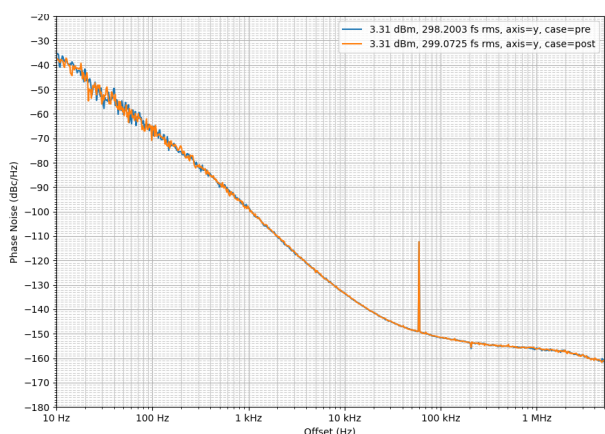


図 8-8. 1500g の前後の機械的衝撃 (25MHz および 25°C、Y 軸)

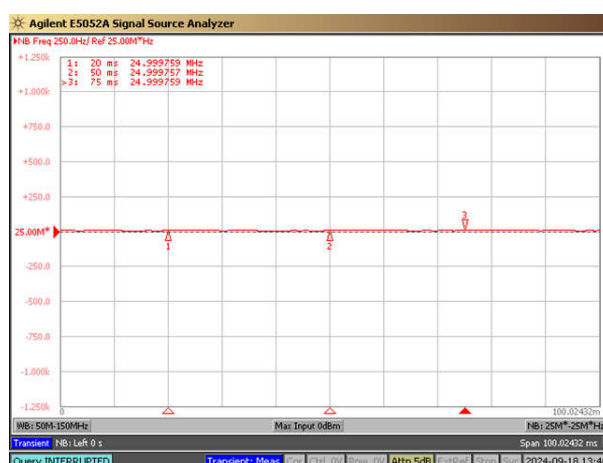


図 8-9. 1500g の間の機械的衝撃 (25MHz および 25°C、Y 軸)

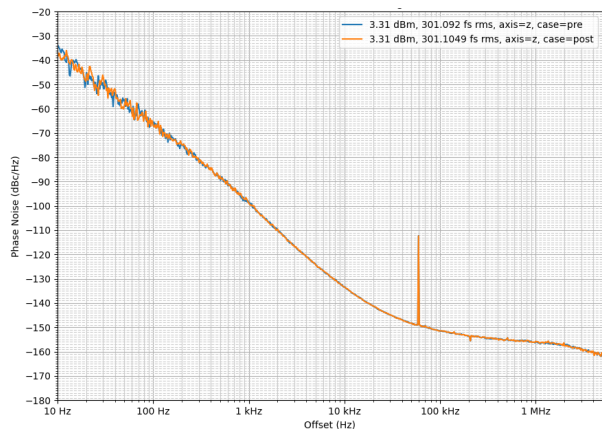


図 8-10. 1500g の前後の機械的衝撃 (25MHz および 25°C、Z 軸)

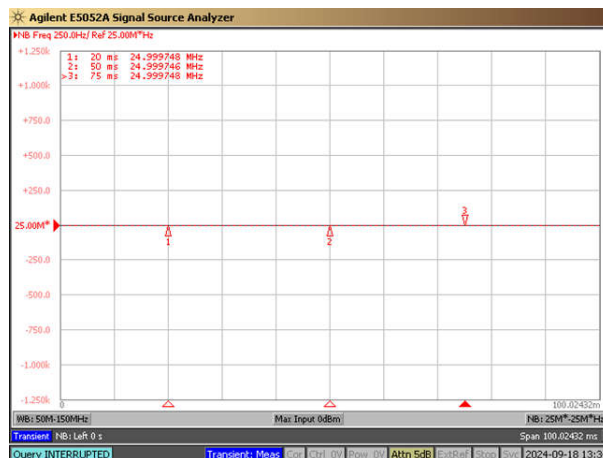


図 8-11. 1500g の間の機械的衝撃 (25MHz および 25°C、Z 軸)

8.4 デバイスの機能モード

CDC6Cx BAW 発振器は定周波数デバイスです。プログラミングは必要ありません。デバイスのピン 1 にはさまざまな機能があり、特定のクロック出力スレーートをデバイスにあらかじめプログラムしておくことができます。機能ピンの詳細については『[セクション 8.3.3](#)』を、各種低速モードの詳細については『[セクション 8.3.5.1](#)』を参照してください。

9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 アプリケーション情報

CDC6Cx は低消費電力の定周波数発振器で、リファレンス クロックとして使用できます。このデバイスは、250kHz ～ 200MHz の任意の出力周波数、シングルエンド出力タイプ、1.8V ～ 3.3V の電源レールをサポートします。

9.1.1 単一の CDC6Cx で複数の負荷を駆動

CDC6Cx 発振器を使用して複数の負荷を駆動することにより、コスト削減と BOM (部品表) の簡素化を実現できます。この方法を使用すると、信号のインテグリティが低下し、性能が低下することに注意してください。複数の負荷を駆動する際は、2 つの負荷のみを駆動すること、負荷全体にわたる共通のパターン長を最大化すること、高速な立ち上がり / 立ち下がり時間を最大化するためにレシーバの合計容量を制限することなど、注意する必要のある一連のガイドラインがあります。この手法の効果と実装ガイドの詳細については、『[単一の LVCMOS 発振器で複数の負荷を駆動](#)』アプリケーションノートを参照してください。

9.2 代表的なアプリケーション

CDC6Cx 発振器をリファレンス回路に実装する際は、[レイアウト例](#)のバイパス コンデンサと AC 結合コンデンサの推奨値を参照してください。出力クロックに必要な終端とバイアスについては、[クロック出力のインターフェイスと終端](#) セクションを参照してください。

図 9-1 に代表的なアプリケーション例を示します。この例では、CDC6Cx 発振器をマイクロコントローラまたは FPGA のリファレンス クロックとして使用します。

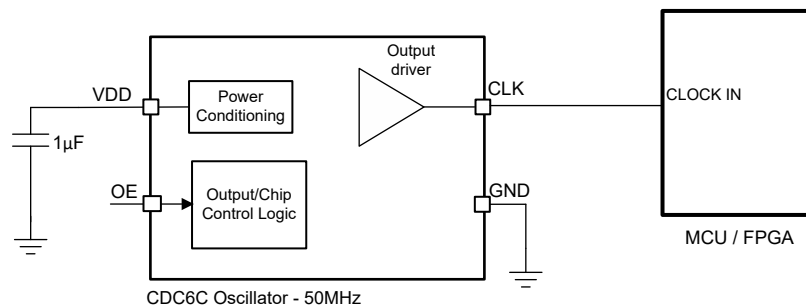


図 9-1. CDC6Cx アプリケーションの例

9.2.1 設計要件

CDC6Cx はプログラミング不要の定周波数発振器です。「クロック出力のインターフェイスと終端」セクションで説明している推奨終端オプションに確実に従ってください。ピン 1 の機能について理解し、出力イネーブル (OE)、スタンバイ (ST) オプションの要件に応じて部品番号を注文するには、「[セクション 8.3.3](#)」を参照してください。

9.2.2 詳細な設計手順

CDC6Cx は LDO を内蔵しており、「電気特性」表に示すように、優れた PSRR 性能を備えています。[「CDC6CEVM User's Guide」](#)を参照して、CDC6Cx BAW 発振器を設計に使用する場合のリファレンス レイアウトをご確認ください。

CDC6Cx のピン 1 の機能を設定するには、標準的な 10kΩ 以下の抵抗を VDD に接続して、OE ピンを High に駆動します。デバイスには 100kΩ を上回る内部プルアップ抵抗があるため、外部プルアップ抵抗が不要な場合は、このピンを

オープンのままにできます。OE ピンを Low に駆動するには、標準的な 10k Ω 以下の抵抗をプルダウン抵抗として使用します。

9.2.3 アプリケーション曲線

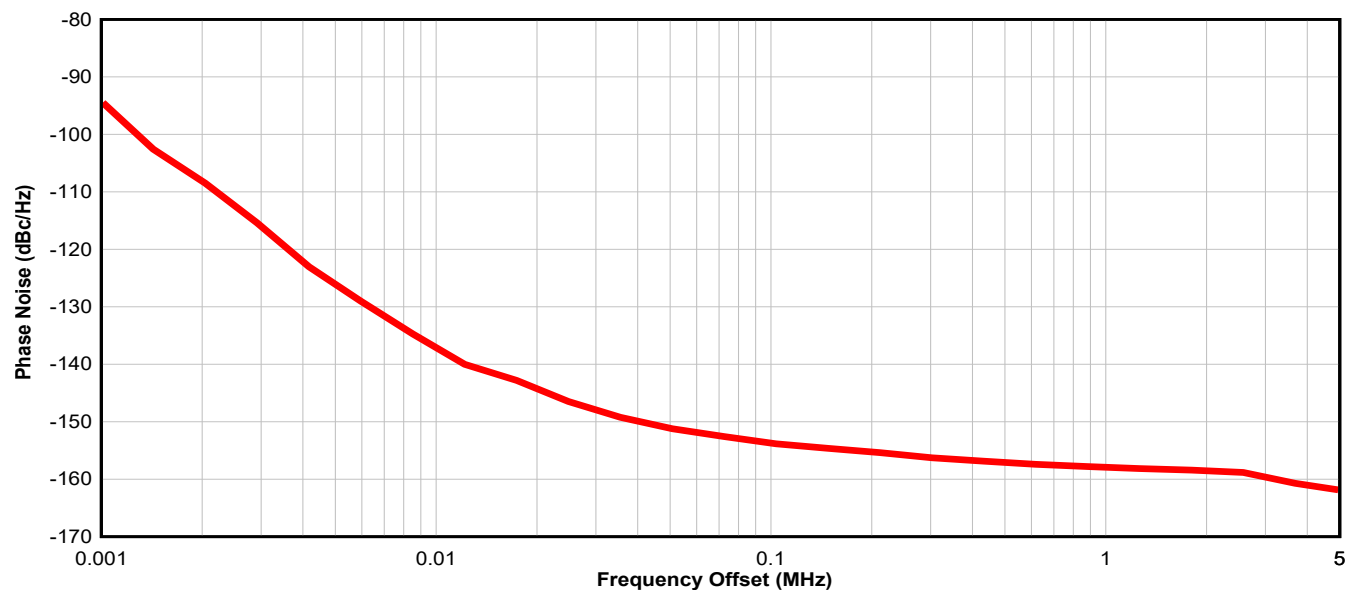


図 9-2. 19.2MHz LVCMOS、25°C、3.3V 電源

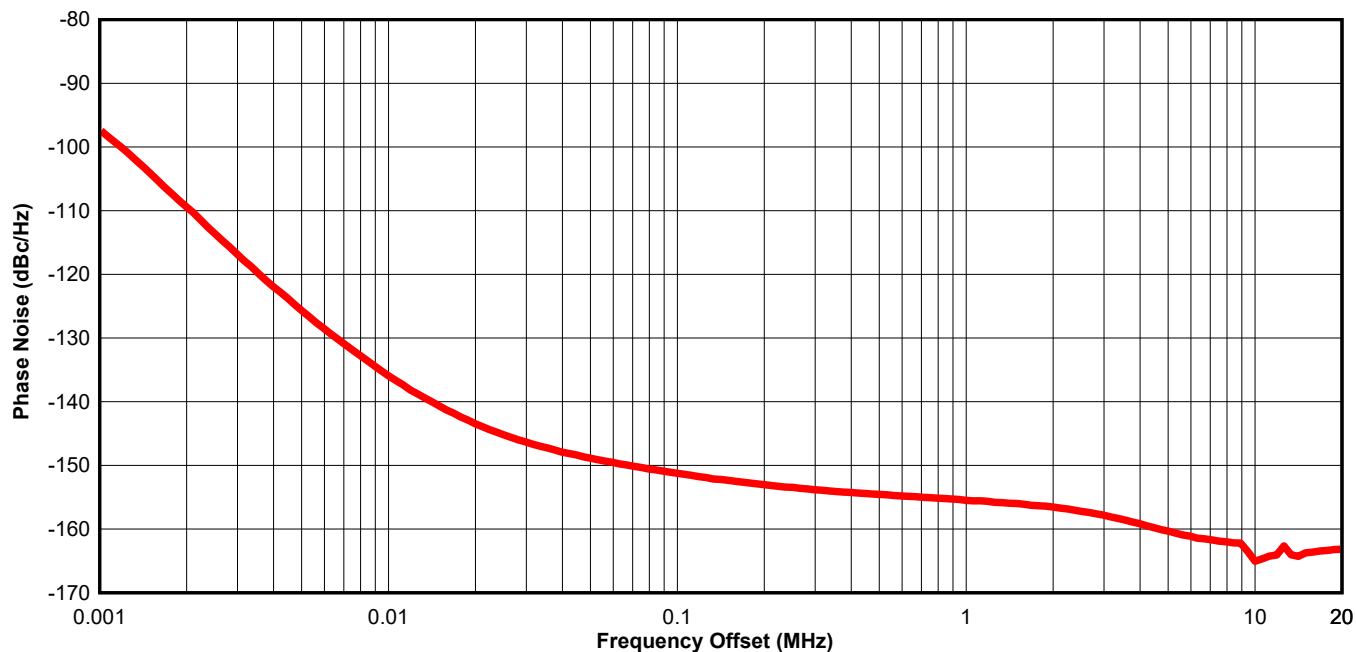


図 9-3. 25MHz LVCMOS、25°C、3.3V 電源

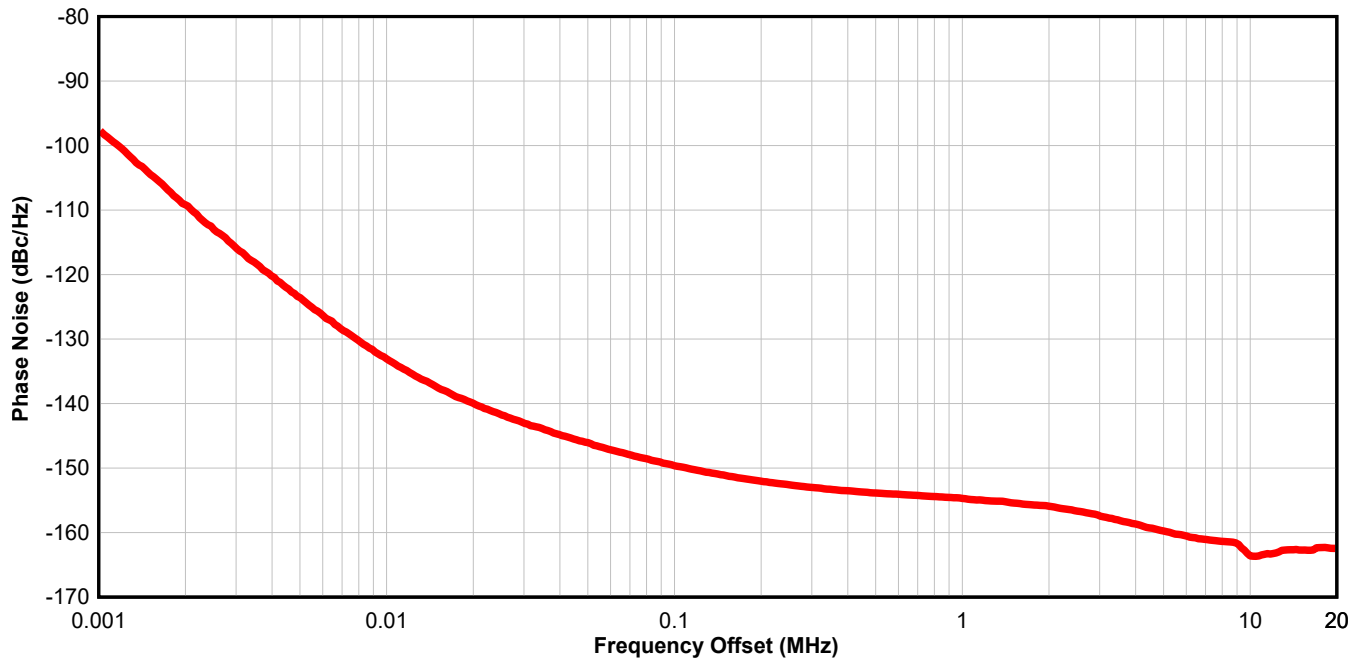


図 9-4. 27MHz LVCMOS、25°C、3.3V 電源

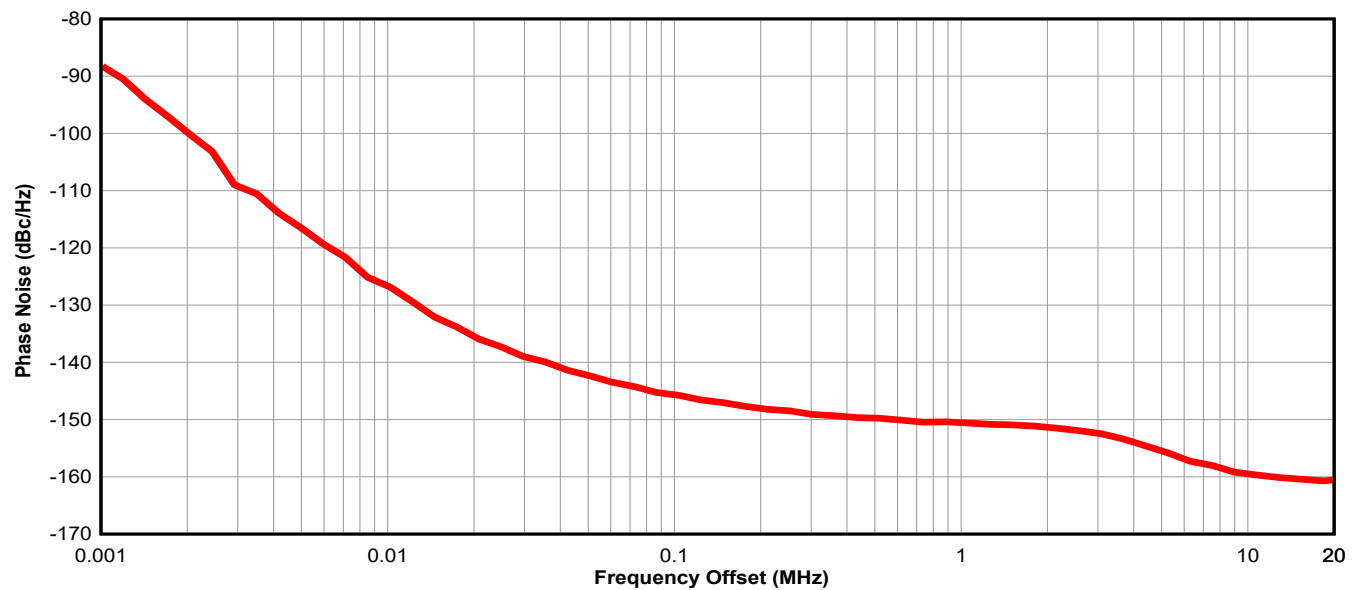


図 9-5. 50MHz LVCMOS、25°C、3.3V 電源

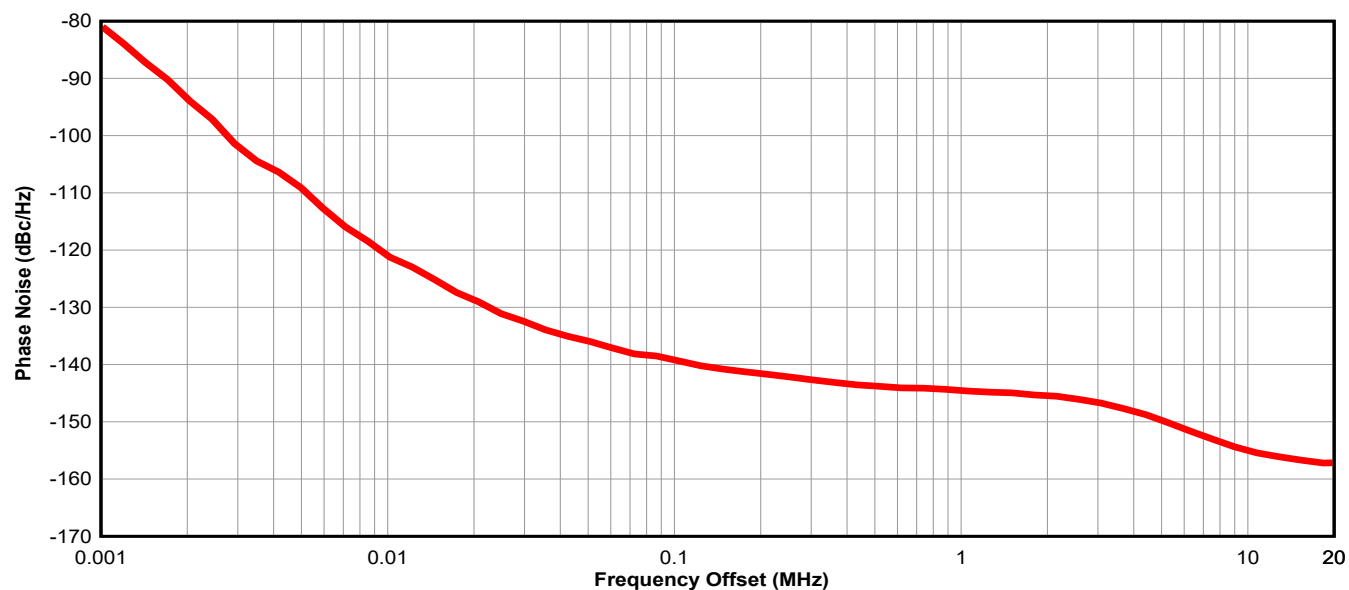


図 9-6. 100MHz LVC MOS、25°C、3.3V 電源

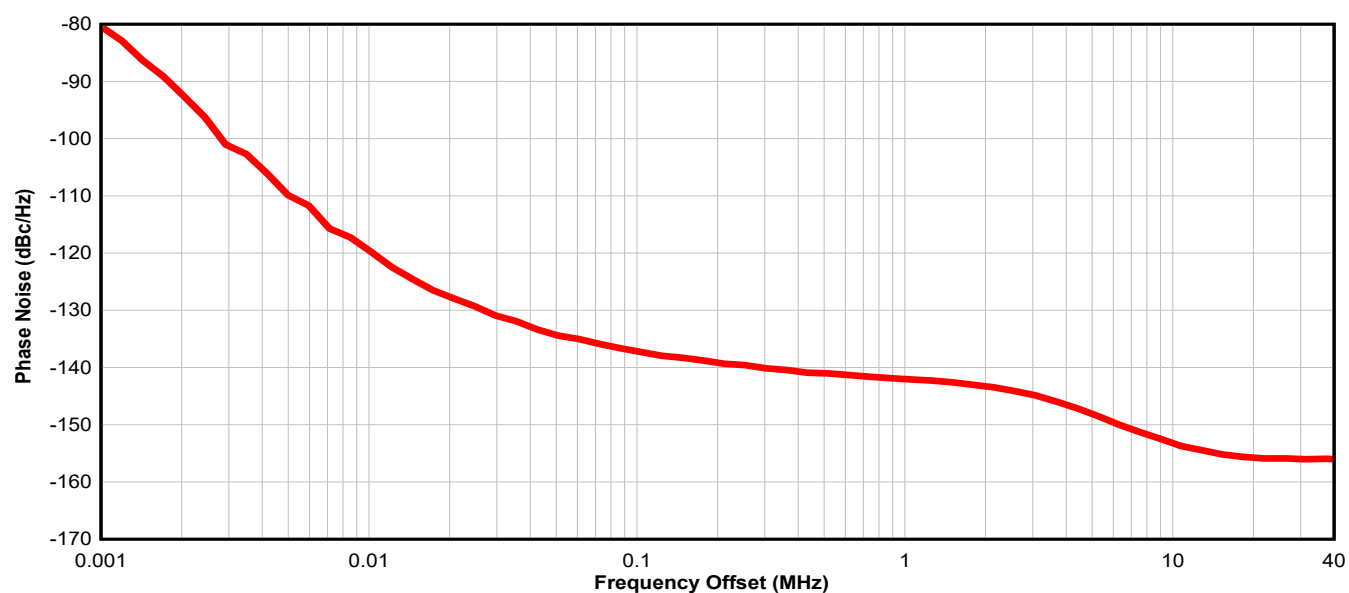


図 9-7. 125MHz LVC MOS、25°C、3.3V 電源

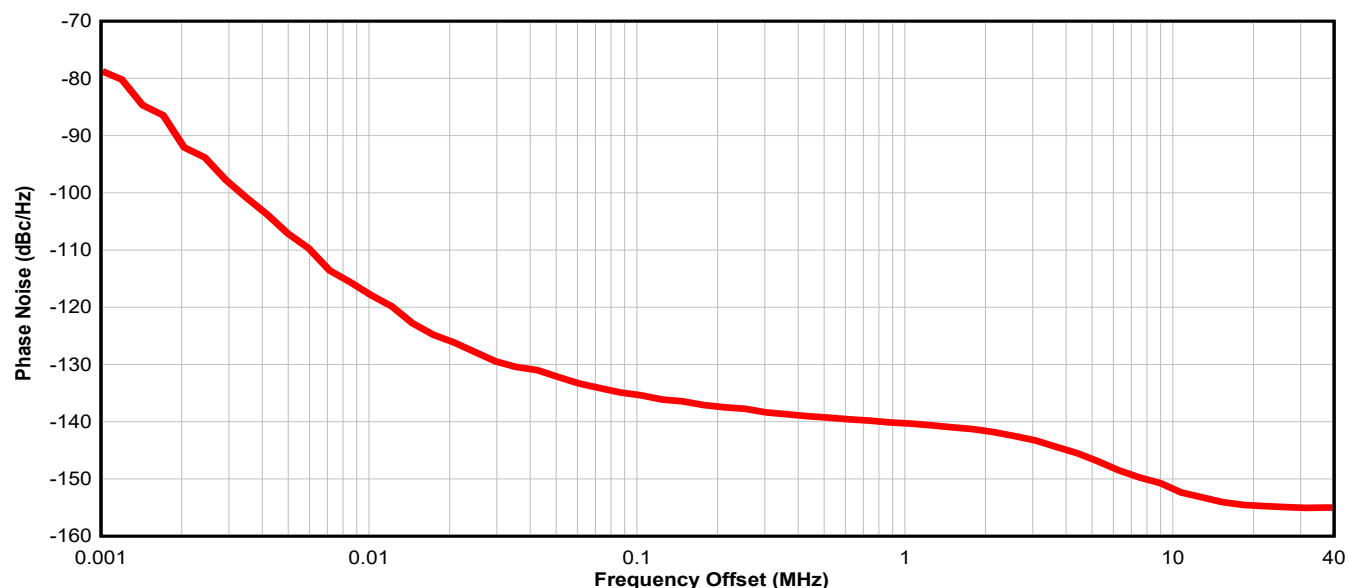


図 9-8. 156.25MHz LVCMOS、25°C、3.3V 電源

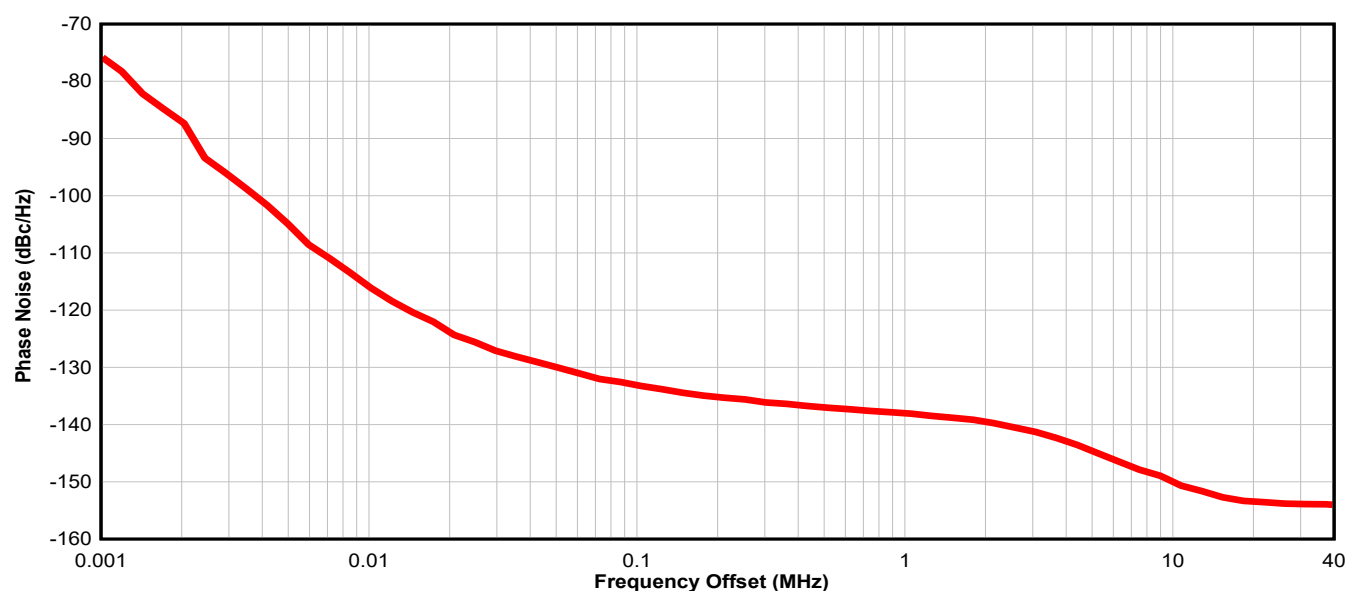


図 9-9. 200MHz LVCMOS、25°C、3.3V 電源

9.3 電源に関する推奨事項

CDC6Cx に最高の電氣的性能を発揮させるため、単一の 1 μ F 電源バイパス コンデンサを使用することをお勧めします。また、電源バイパス コンデンサを部品面に実装することをお勧めします。本体サイズ 0201 または 0402 のコンデンサにより、最適な信号配線を実現できます。バイパス コンデンサとデバイスの電源との間の接続はできる限り短くします。グランドプレーンへの低インピーダンス接続を使用して、コンデンサの反対側をグランドに接続します。

V_{DD} パワーアップ ランプ時間は、電源が公称 V_{DD} の 95%を超えるまでの最小時間として定義されます。単調な電源ランプを想定しています。電源が 1.5V を超えてから 1V ~ 1.5V の範囲に低下した場合、電源が再び 1.5V を超えると出力がミューツされます。 V_{DD} が 1V 未満に低下し、1.5V を超えるまで上昇すると、出力クロックが回復します。

9.4 レイアウト

9.4.1 レイアウトのガイドライン

以下のセクションでは、基板レイアウト、半田リフロー プロファイル、および CDC6Cx を使用してシステム全体の良好な熱特性と電氣的性能、および信号のインテグリティを実現するときの電源バイパスについての推奨事項を示します。

9.4.1.1 熱に関する信頼性の実現

CDC6Cx は低消費電力の高性能デバイスです。そのため、消費電力に関しデバイスの構成とプリント基板 (PCB) レイアウトに十分な注意を払ってください。パッケージからの熱放散を最大化するため、グランド ピンは 3 つ以上のビアで PCB のグランド プレーンに接続する必要があります。

次の式は、CDC6Cx 付近の PCB 温度と接合部温度の関係を示します。

$$T_B = T_J - \Psi_{JB} \times P \quad (1)$$

ここで、

- T_B : CDC6Cx 付近の PCB 温度
- T_J : CDC6Cx の接合部温度
- Ψ_{JB} : CDC6Cx の接合部から基板への熱抵抗パラメータ (この情報については、[仕様](#) セクションの「熱に関する情報」の表を参照)
- P : CDC6Cx のオンチップ消費電力

9.4.1.2 推奨される半田リフロー プロファイル

J-STD-020E のガイドラインで定められた範囲内で、フラックスの活性度を最適化し、合金の適切な溶融温度を実現するために、半田ペースト サプライヤから提供された推奨事項に従ってください。ピーク温度を可能な限り低く保つと同時に、MSL ラベルに記載されている部品のピーク温度定格未満に保って CDC6Cx を処理することをお勧めします。正確な温度プロファイルは、MSL ラベルに記載されている部品の最大ピーク温度定格、基板の厚さ、PCB 材料の種類、PCB 形状、部品の位置、サイズ、PCB 内の密度、半田メーカー推奨のプロファイル、SMT アセンブリ動作で確認されたリフロー装置の能力など、いくつかの要因に依存します。

9.4.2 レイアウト例

図 9-10 に、CDC6Cx の評価基板 (EVM) で行われたプリント基板 (PCB) レイアウトの例を示します。

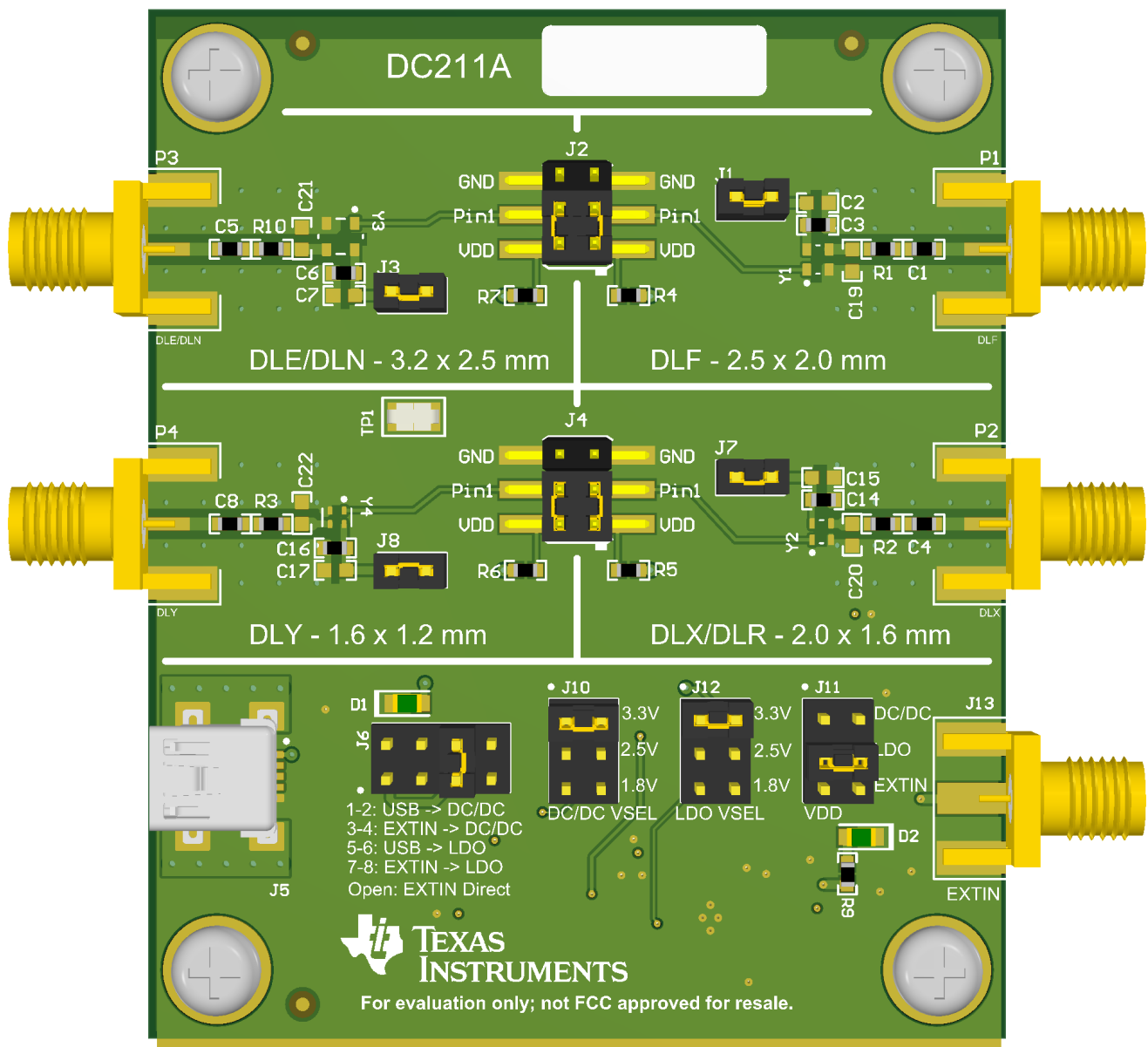


図 9-10. CDC6 EVM の PCB レイアウト例

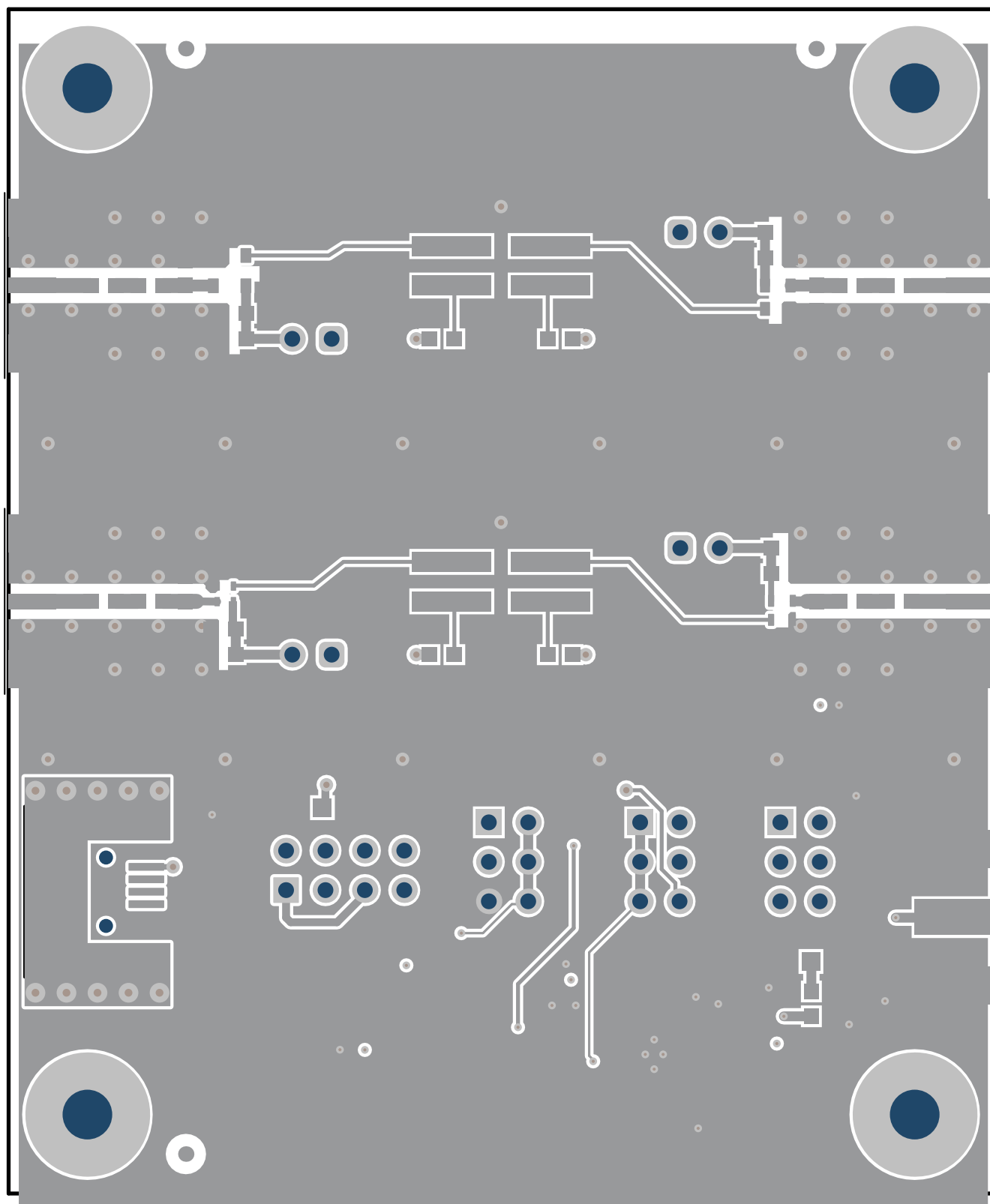


図 9-11. CDC6 EVM の PCB レイアウト例 — 最上層

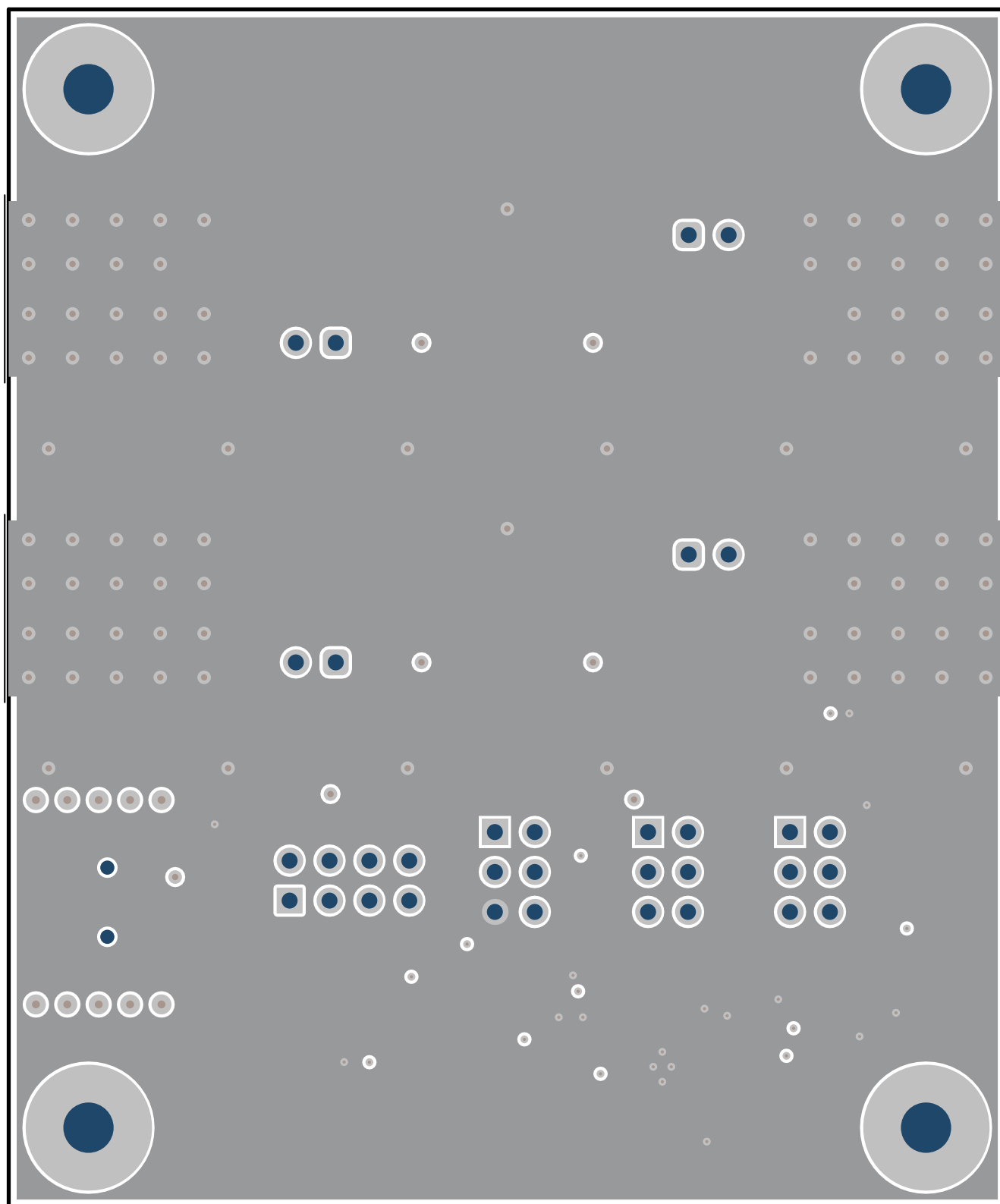


図 9-12. CDC6 EVM の PCB レイアウト例 — GND レイヤ

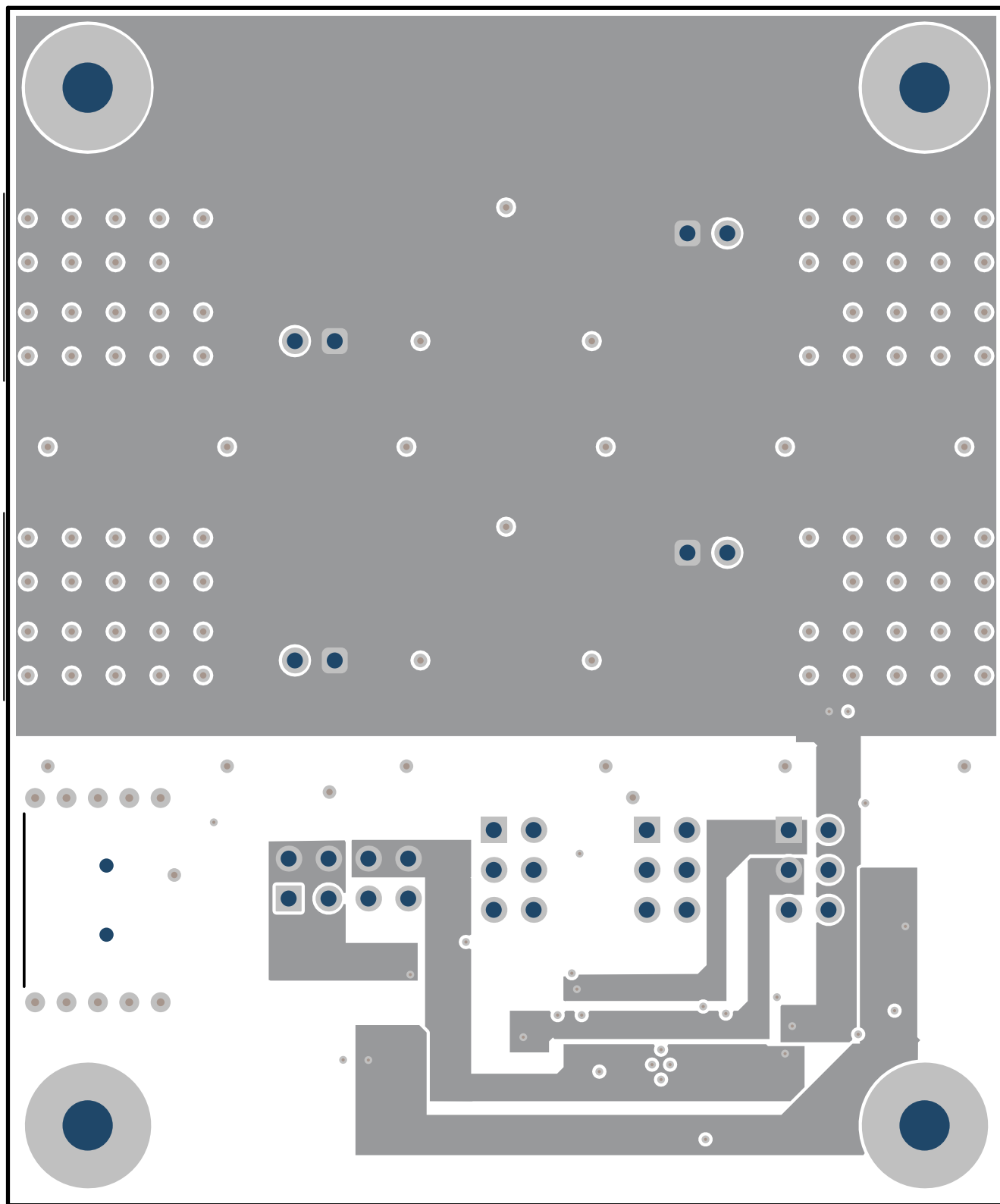


図 9-13. CDC6 EVM の PCB レイアウト例 — 電源層

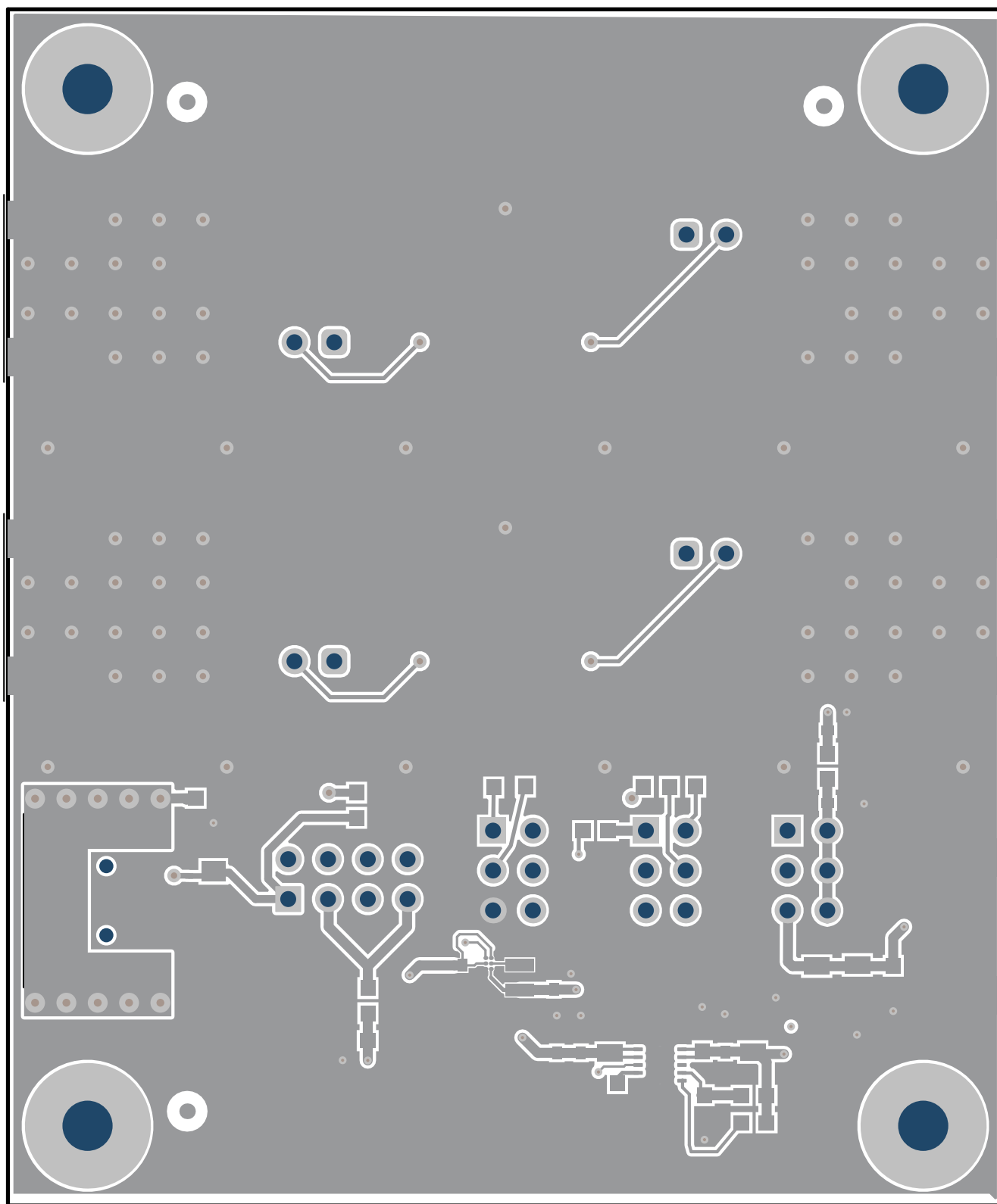


図 9-14. CDC6 EVM の PCB レイアウト例 — 最下層

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、システムの開発を行うためのツールやソフトウェアを、以下に挙げます。

10.1 ドキュメントのサポート

10.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[CDC6CEVM ユーザーガイド](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[CDC6C OPN デコーダ](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[CDC6C-Q1 の機能安全性 — FIT 率、FMD、ピン FMA](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[水晶発振器に対するスタンドアロン BAW 発振器の利点](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[単一の LVCMOS 発振器で複数の負荷を駆動](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[CDC6Cx-Q1 CISPR25 放射エミッション性能レポート](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[ビルディング オートメーション向け BAW 発振器デザイン](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ファクトリ オートメーション向け BAW 発振器デザイン](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[グリッド インフラ向け BAW 発振器デザイン](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[光モジュール向け BAW 発振器デザイン](#)』アプリケーション ノート

10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

10.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

10.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

10.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision C (July 2025) to Revision D (January 2026)
Page

• 仕様表に合わせて最初のページの仕様に訂正を追加し、汎用ランド パターンに関するコメントを追加.....	1
• 注文可能な低速モード オプションについて説明するため、「 EMI 低減 および 低速モード オプション 」への参照を追 加	3
• 最低保管温度を追加.....	5
• 立ち上がりおよび立ち下がり時間の標準値 10% ~ 90%を追加.....	6
• 出力インピーダンスの最小値と最大値を削除.....	6
• 設計に関する最近の調査結果に基づいて入力電流を更新.....	6
• スタンバイおよび出力イネーブルの仕様を明確化するため変更し、 ≤100MHz の仕様を追加.....	6
• スタンバイおよび出力イネーブル ピンのパワーオン特性を説明するための図を追加.....	9
• 構造上の一貫性のため HIGH 機能と LOW 機能の順序を変更.....	15
• EMI 低減 情報を作成し、「 詳細な設計手順 」から情報を移動.....	16
• 低速モードオプションに使用するコンデンサが最小推奨値であることを強調すること。.....	16
• セクション 8.3.7 を追加.....	17
• セクション 8.3.5.1 への参照を追加.....	20

Changes from Revision B (May 2025) to Revision C (July 2025)	Page
• 各パッケージ サイズの周波数安定性を規定.....	1
• パッケージ サイズごとに注文可能な周波数安定性オプションを規定.....	1
• DLE、DLF、DLX パッケージの周波数安定性の向上を規定.....	15

Changes from Revision A (January 2025) to Revision B (May 2025)	Page
• ドキュメント全体にわたって、表、図、クロスリファレンスの採番方法を更新.....	1
• 「ピン機能」表の色の割り当てを説明するため凡例を追加.....	4
• すべての出力の立ち上がり時間/立ち下がり時間データに使用される出力周波数を追加.....	6
• -40°C から 85°C までの温度範囲の周波数安定性を追加.....	6
• 特定の出力周波数ではなく、出力周波数範囲に基づくジッタ値を示すためにランダム位相ジッタを組み合わせ.....	6
• 25MHz 出力に 12kHz ~ 20MHz オフセットにランダム位相ジッタを含めるよう変更.....	6
• RMS 周期ジッタの積分帯域幅を削除.....	6
• 図 6-10 を、20MHz による周波数オフセットを含めるように更新。.....	11
• 「詳細な設計手順」を更新し、25MHz の出力周波数を指定、「電気的特性」の表に合わせて立ち上がりおよび立ち下がり時間を訂正。.....	21
• 図 9-3 および 図 9-4 に、20MHz によって周波数オフセットを含めるよう変更。.....	23
• 「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを更新.....	36

Changes from Revision * (December 2024) to Revision A (January 2025)	Page
• ドキュメント全体にわたって、表、図、クロスリファレンスの採番方法を更新.....	1
• セクション 8.3.5 と セクション 8.3.5.1 を『機能説明』の独立した個別のセクションに移動.....	16
• V _{DD} パワーアップ ランプ時間要件を削除 (特定のパワーアップ要件が不要になったため).....	26

12 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CDC6CA008000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	HB
CDC6CA025000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AB
CDC6CA025000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AB
CDC6CA025000EDLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	8A
CDC6CA050000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	KB
CDC6CA050000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	KB
CDC6CE008000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	TA
CDC6CE008000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	TA
CDC6CE008000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	TA
CDC6CE008000ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	TA
CDC6CE008192ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	MA
CDC6CE008192ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	MA
CDC6CE008192ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	MA
CDC6CE008192ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	MA
CDC6CE012000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	1A
CDC6CE012288ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	FA
CDC6CE012288ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	FA
CDC6CE012288ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	FA
CDC6CE012288ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	FA
CDC6CE016000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	BA
CDC6CE019200ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	IA
CDC6CE019200ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	IA
CDC6CE019200ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	IA
CDC6CE019200ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	IA
CDC6CE019200EDLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	5A
CDC6CE020000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	EA
CDC6CE020000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	EA
CDC6CE020000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	EA
CDC6CE020000ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	EA

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CDC6CE024000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	DA
CDC6CE024000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	DA
CDC6CE024000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	DA
CDC6CE024000ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	DA
CDC6CE024000EDLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	7A
CDC6CE025000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AA
CDC6CE025000ADLER.A	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AA
CDC6CE025000ADLER.B	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 105	
CDC6CE025000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AA
CDC6CE025000ADLFR.A	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AA
CDC6CE025000ADLFR.B	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 105	
CDC6CE025000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AA
CDC6CE025000ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AA
CDC6CE025000ADLYR.A	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AA
CDC6CE025000ADLYR.B	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 105	
CDC6CE025000CDLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	OB
CDC6CE025000EDLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	4A
CDC6CE025000EDLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	4A
CDC6CE025000EDLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	4A
CDC6CE026000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	XB
CDC6CE026000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	XB
CDC6CE026000EDLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	6A
CDC6CE027000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	JA
CDC6CE027000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	JA
CDC6CE027000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	JA
CDC6CE027000ADLXR.A	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	JA
CDC6CE027000ADLXR.B	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 105	
CDC6CE027000ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	JA
CDC6CE032768ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	VB
CDC6CE032768ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	VB
CDC6CE033333ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	HA

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CDC6CE03333ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	HA
CDC6CE03333ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	HA
CDC6CE03333ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	HA
CDC6CE038400EDLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	NB
CDC6CE040000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	GA
CDC6CE040000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	GA
CDC6CE040000ADLFR.A	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	GA
CDC6CE040000ADLFR.B	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 105	
CDC6CE040000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	GA
CDC6CE040000ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	GA
CDC6CE040000EDLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	JB
CDC6CE048000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	KA
CDC6CE048000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	KA
CDC6CE048000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	KA
CDC6CE048000ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	KA
CDC6CE050000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	CA
CDC6CE050000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	CA
CDC6CE050000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	CA
CDC6CE050000ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	CA
CDC6CE050000EDLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	2A
CDC6CE100000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	LA
CDC6CE100000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	LA
CDC6CE125000ADLER	Active	Production	VSON (DLE) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	OA
CDC6CE125000ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	OA
CDC6CE125000ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	OA
CDC6CE125000ADLYR	Active	Production	VSON (DLY) 4	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	OA
CDC6CE156250ADLFR	Active	Production	VSON (DLF) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	NA
CDC6CE156250ADLXR	Active	Production	VSON (DLX) 4	3000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	NA

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF CDC6C :

- Automotive : [CDC6C-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CDC6CA008000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CA025000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CA025000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CA025000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CA050000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CA050000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE008000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE008000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE008000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE008000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE008192ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE008192ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE008192ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE008192ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE012000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE012288ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CDC6CE012288ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE012288ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE012288ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE016000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE019200ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE019200ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE019200ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE019200ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE019200EDLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE020000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE020000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE020000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE020000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE024000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE024000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE024000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE024000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE024000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE025000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE025000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE025000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE025000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE025000CDLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE025000EDLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE025000EDLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE025000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE026000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE026000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE026000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE027000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE027000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE027000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE027000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE032768ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE032768ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE033333ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE033333ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE033333ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE033333ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE038400EDLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE040000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CDC6CE040000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE040000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE040000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE040000EDLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE048000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE048000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE048000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE048000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE050000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE050000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE050000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE050000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE050000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE100000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE100000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE125000ADLER	VSON	DLE	4	3000	330.0	12.4	2.8	3.5	1.2	4.0	12.0	Q1
CDC6CE125000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE125000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1
CDC6CE125000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	180.0	8.4	1.45	1.9	1.07	4.0	8.0	Q1
CDC6CE156250ADLFR	VSON	DLF	4	3000	180.0	8.4	2.25	2.8	1.1	4.0	8.0	Q1
CDC6CE156250ADLXR	VSON	DLX	4	3000	180.0	8.4	1.85	2.3	1.16	4.0	8.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

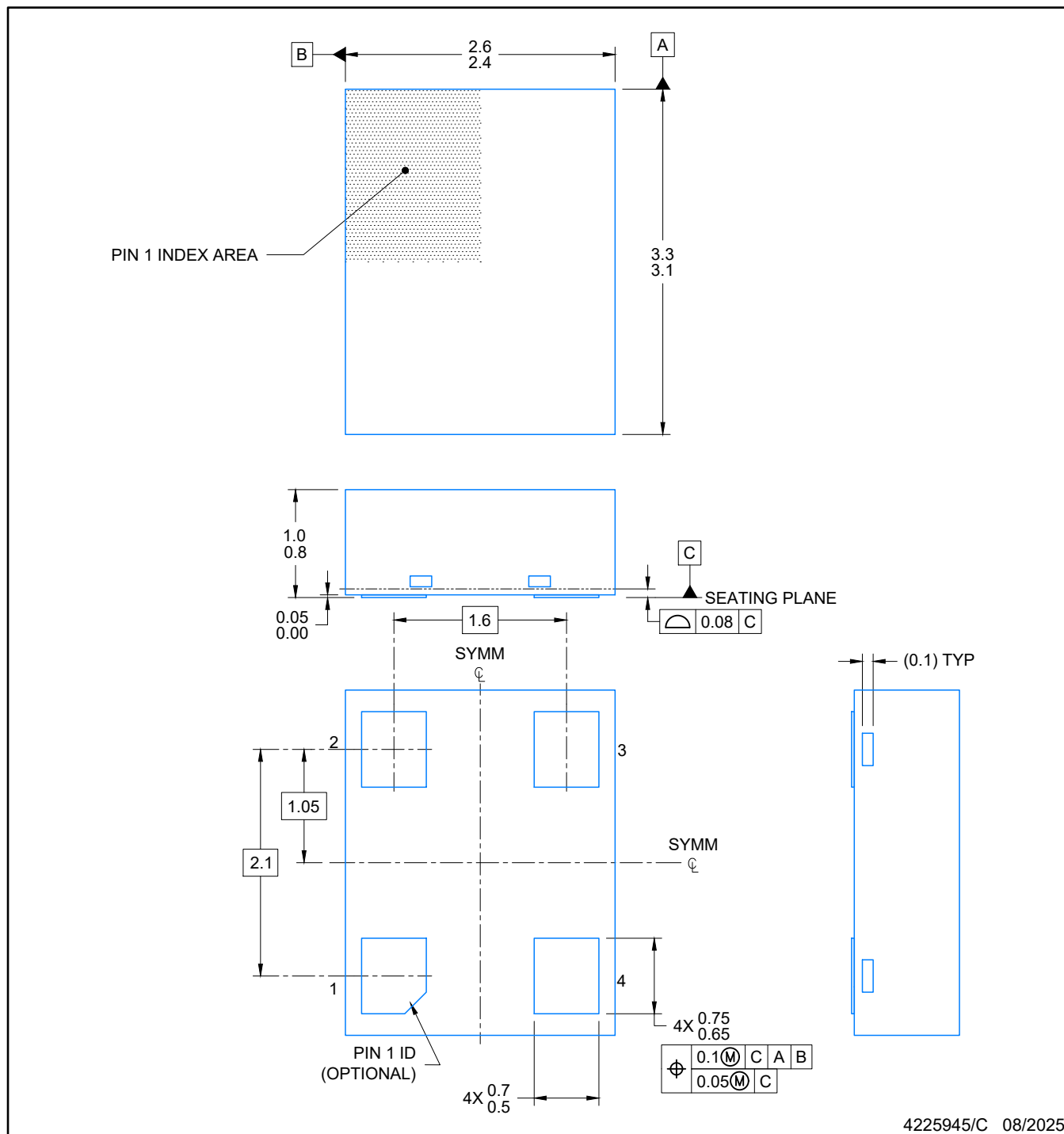


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CDC6CA008000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CA025000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CA025000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CA025000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CA050000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CA050000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE008000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE008000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE008000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE008000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE008192ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE008192ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE008192ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE008192ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE012000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE012288ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE012288ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE012288ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0

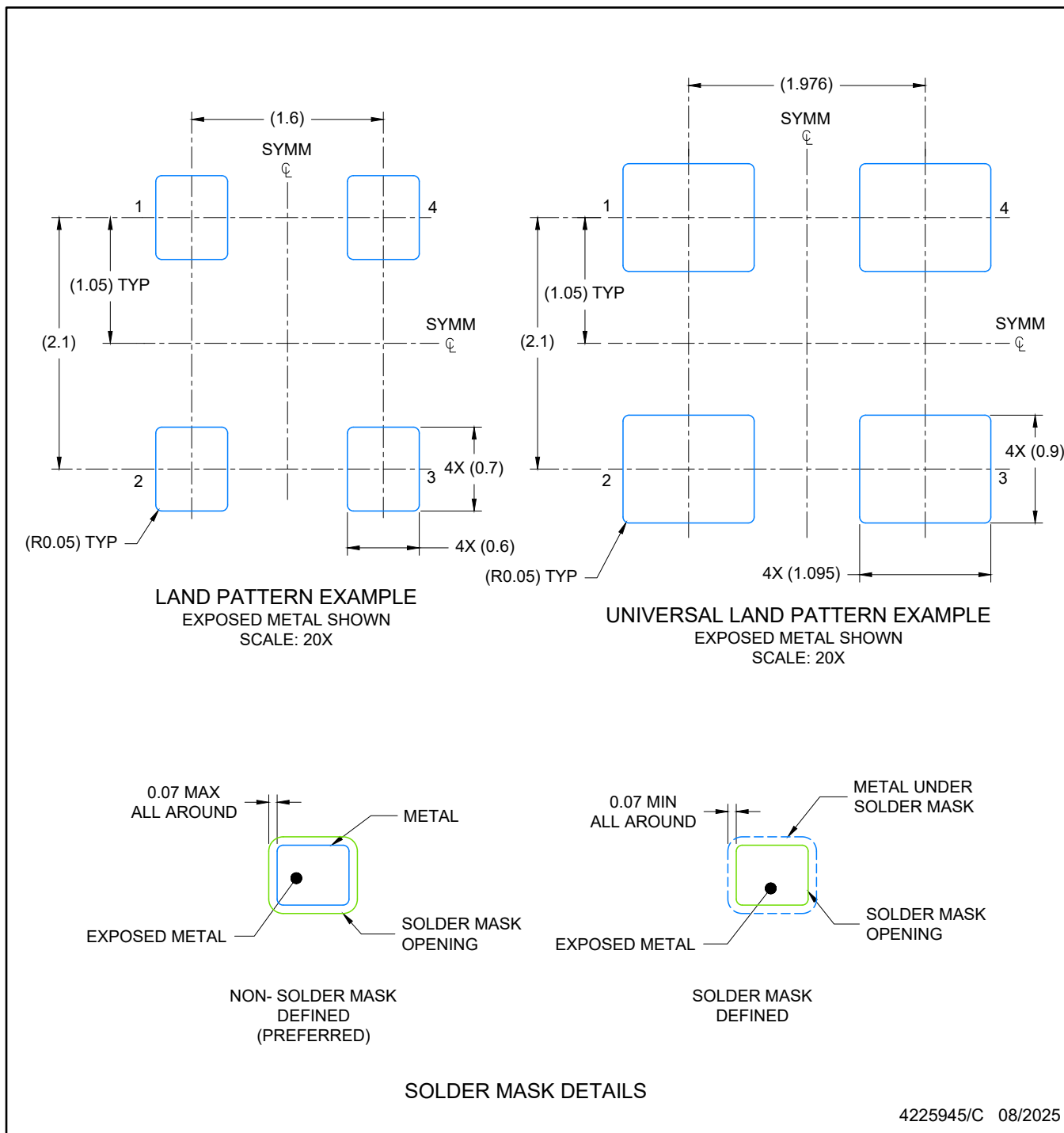
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CDC6CE012288ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE016000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE019200ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE019200ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE019200ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE019200ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE019200EDLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE020000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE020000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE020000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE020000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE024000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE024000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE024000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE024000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE024000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE025000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE025000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE025000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE025000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE025000CDLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE025000EDLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE025000EDLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE025000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE026000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE026000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE026000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE027000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE027000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE027000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE027000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE032768ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE032768ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE033333ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE033333ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE033333ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE033333ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE038400EDLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE040000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE040000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE040000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE040000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE040000EDLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CDC6CE048000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE048000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE048000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE048000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE050000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE050000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE050000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE050000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE050000EDLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE100000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE100000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE125000ADLER	VSON	DLE	4	3000	367.0	367.0	35.0
CDC6CE125000ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE125000ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE125000ADLYR	VSON	DLY	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE156250ADLFR	VSON	DLF	4	3000	182.0	182.0	20.0
CDC6CE156250ADLXR	VSON	DLX	4	3000	182.0	182.0	20.0



NOTES:

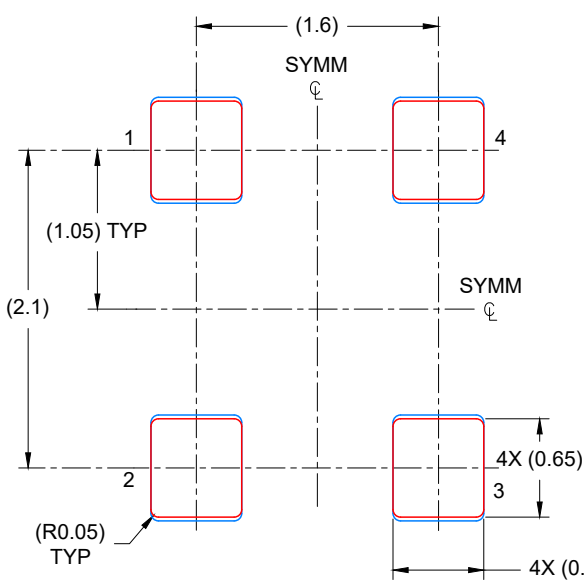
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.



4225945/C 08/2025

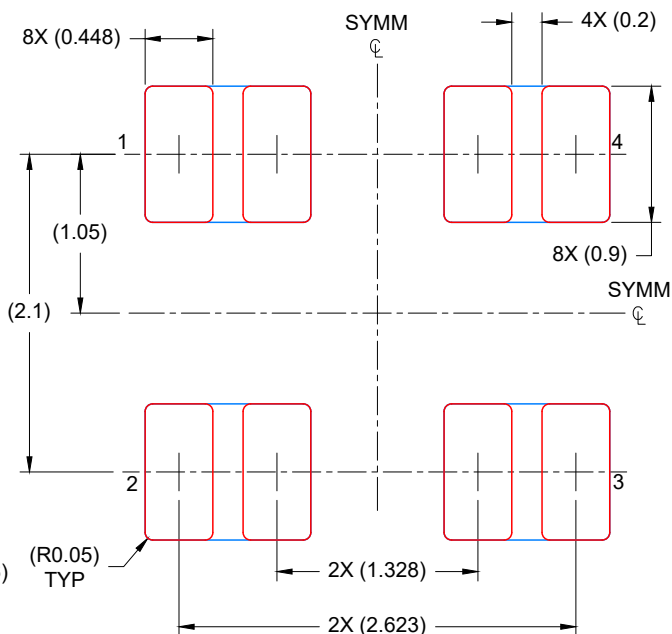
NOTES: (continued)

- For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271) .



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
ALL PADS: 93%
SCALE: 20X



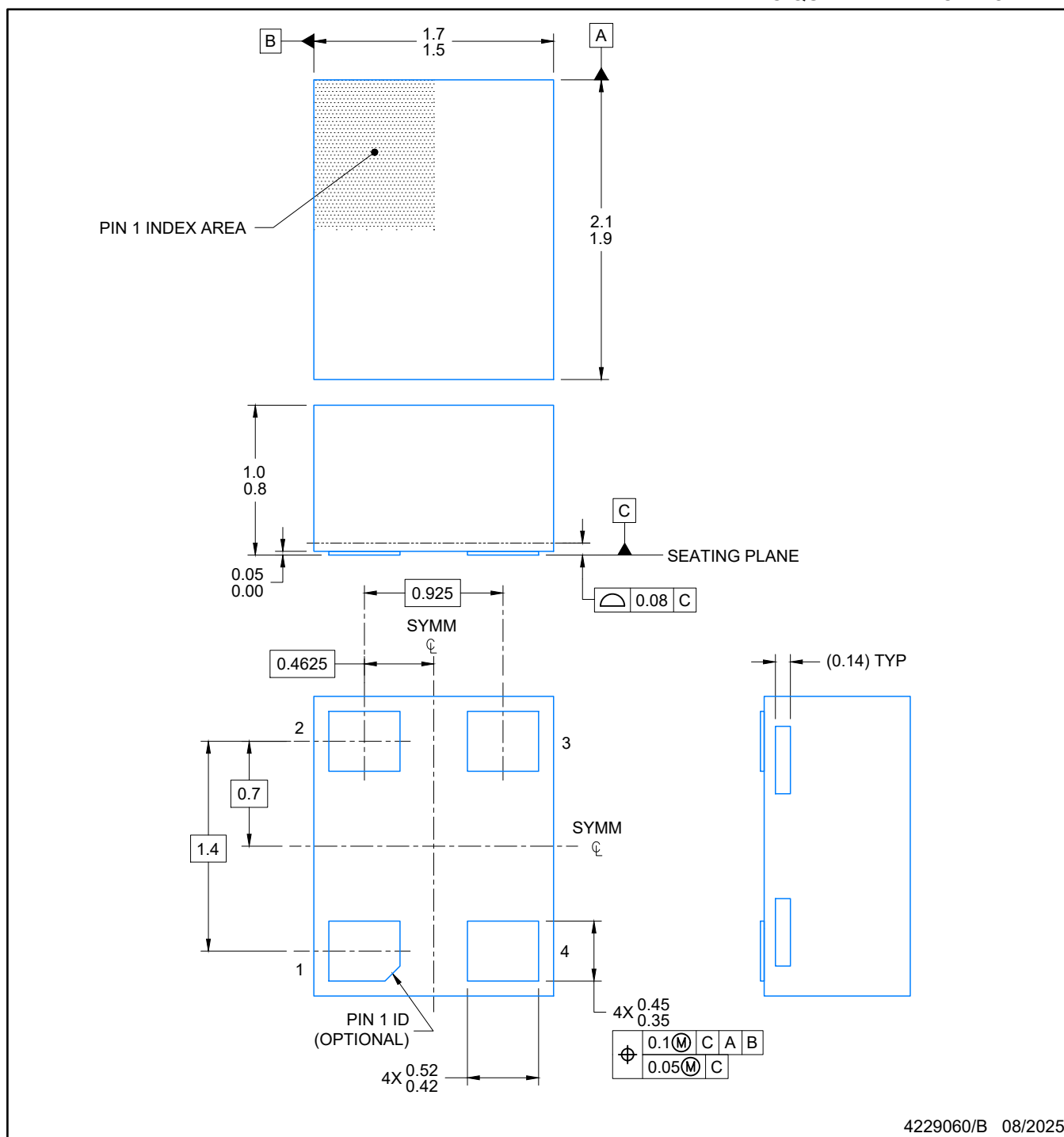
UNIVERSAL SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
ALL PADS: 82%
SCALE: 20X

4225945/C 08/2025

NOTES: (continued)

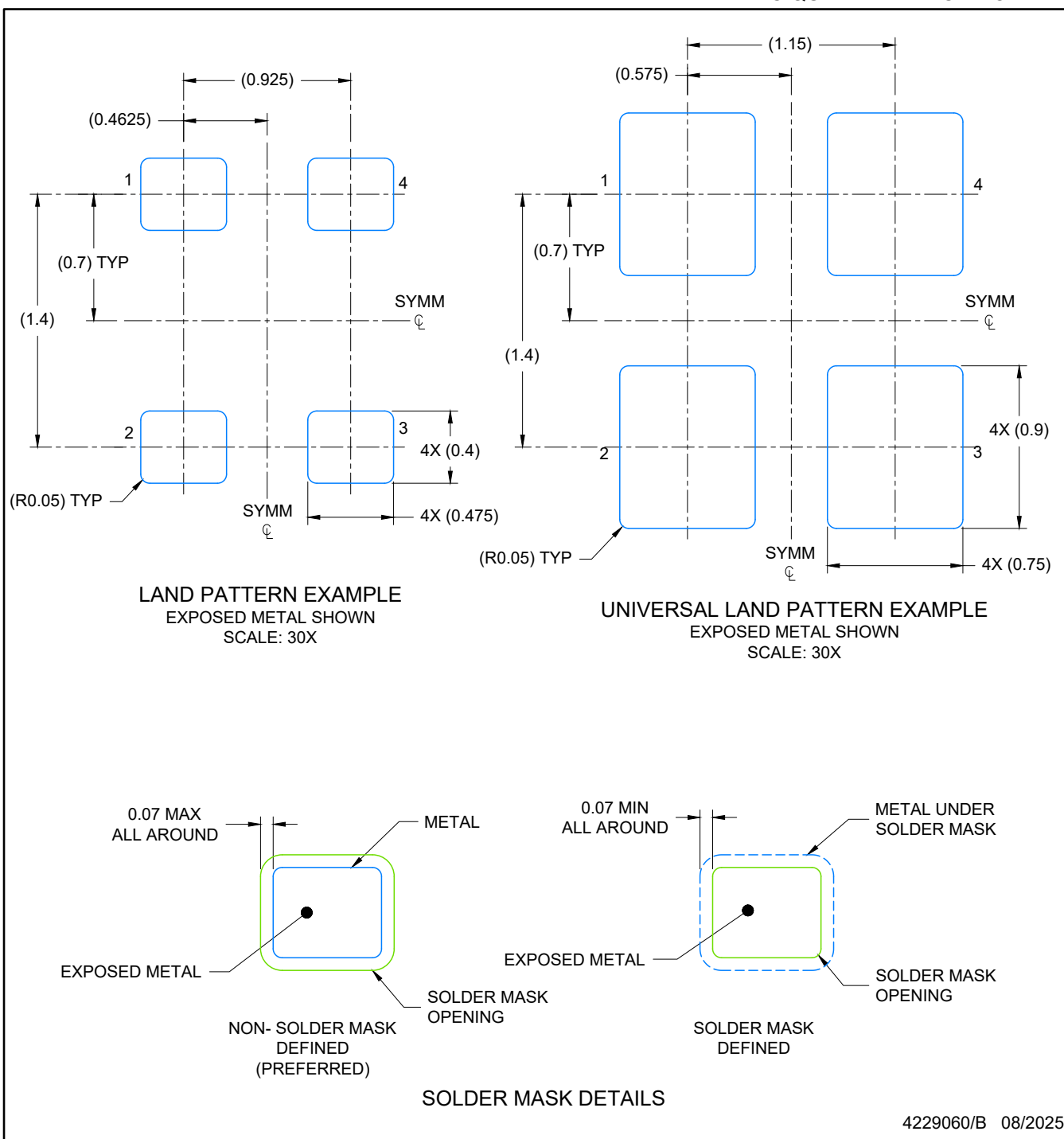
4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.



4229060/B 08/2025

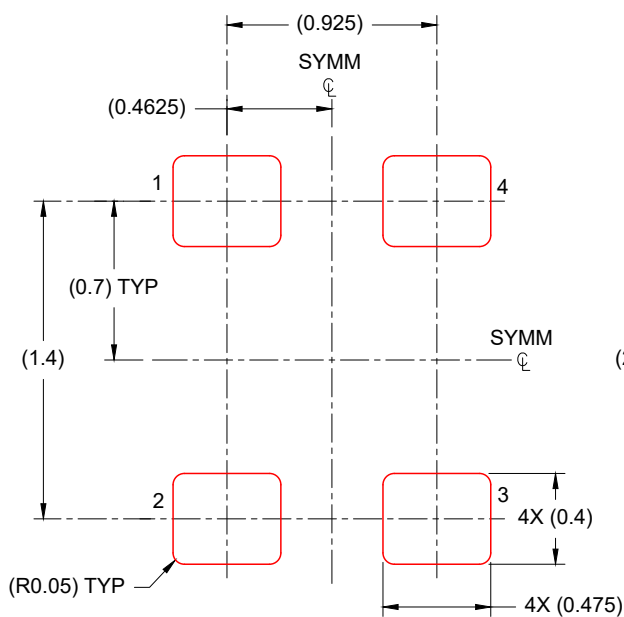
NOTES:

- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.

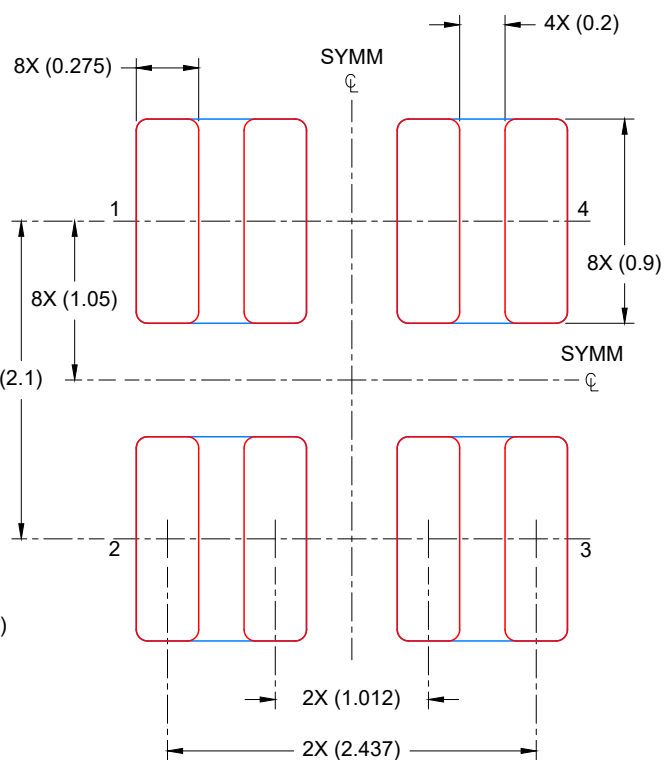


NOTES: (continued)

- For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271) .



SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
 SCALE: 20X



UNIVERSAL SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
 SCALE: 20X

PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
 ALL PADS: 73%

4229060/B 08/2025

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

GENERIC PACKAGE VIEW

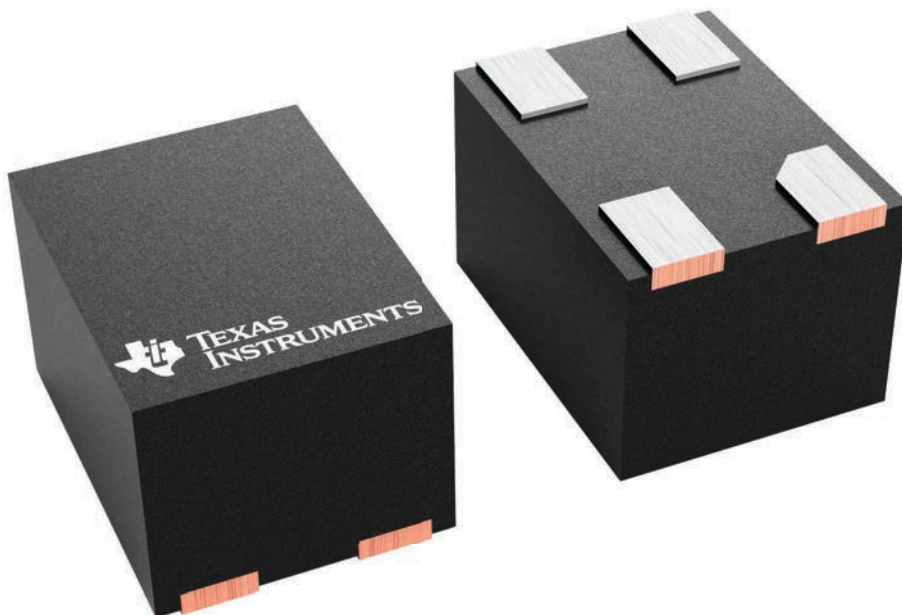
DLY 4

VSON - 1 mm max height

1.6 x 1.2, 0.7 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

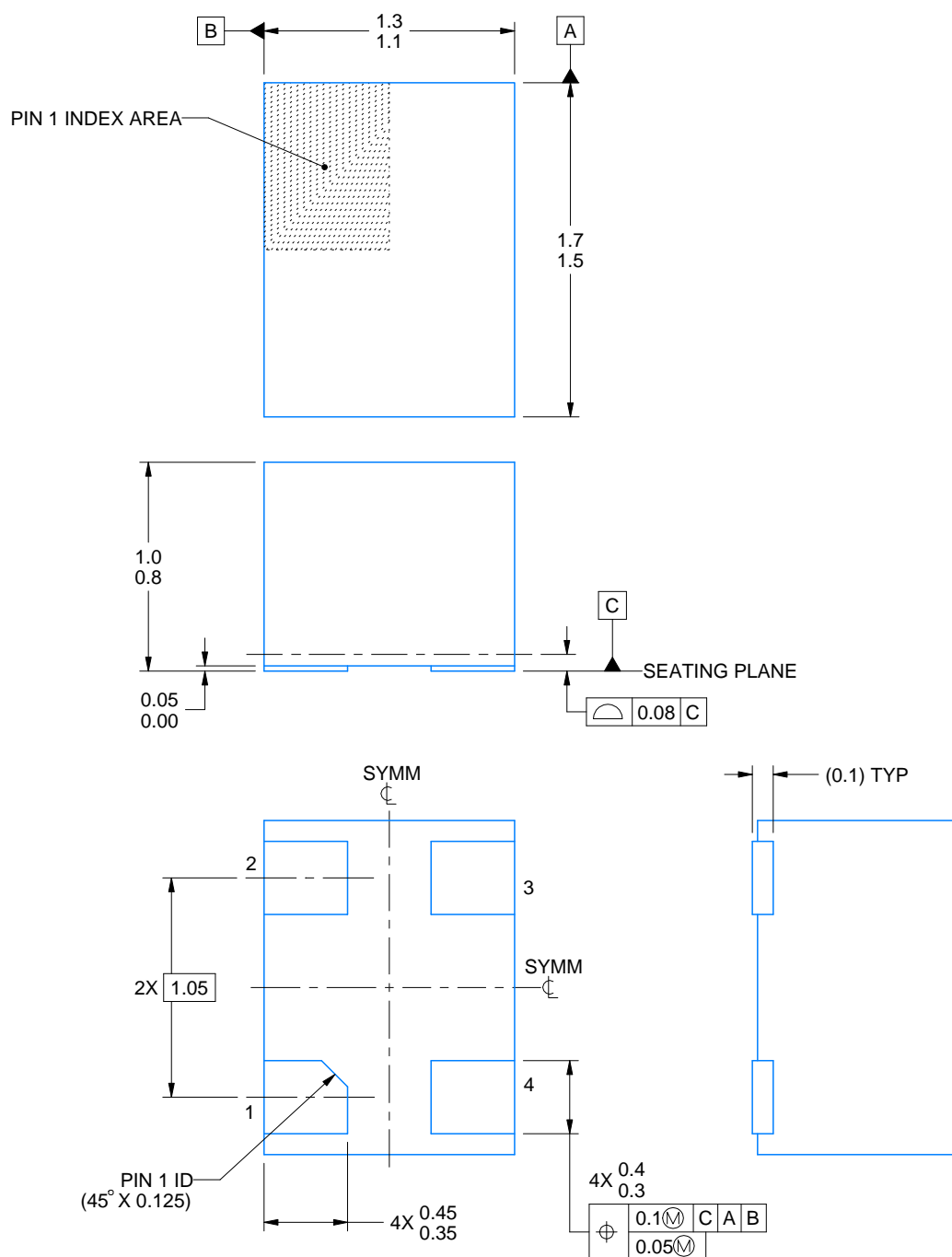
This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.





VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



4229829/B 08/2025

NOTES:

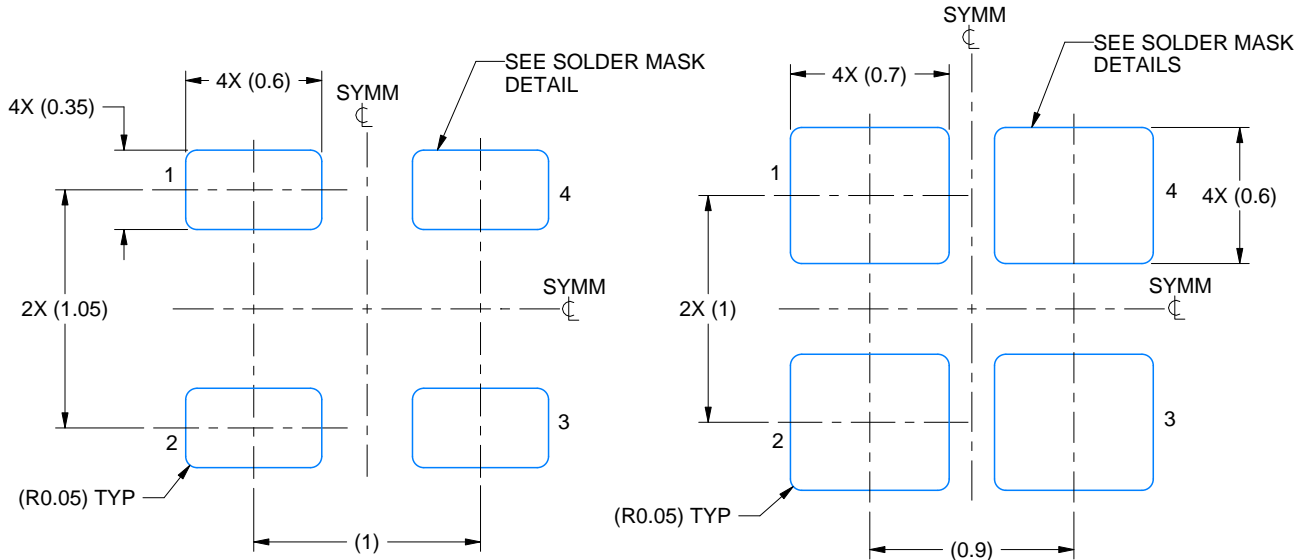
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DLY0004C

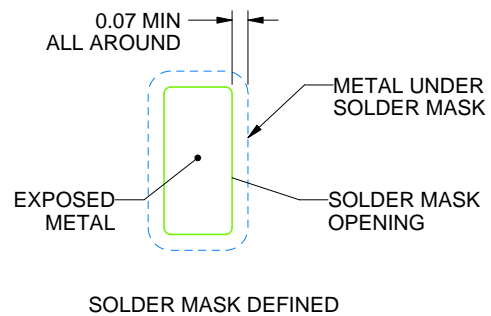
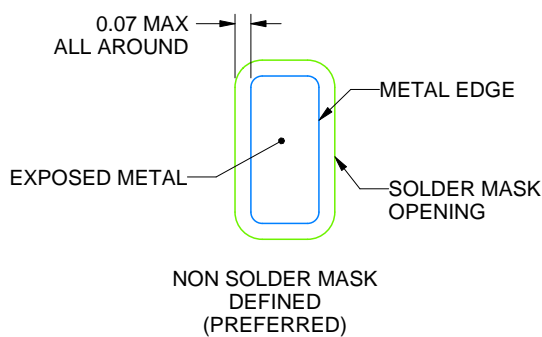
VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 30X

UNIVERSAL LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 30X



SOLDER MASK DETAILS

4229829/B 08/2025

NOTES: (continued)

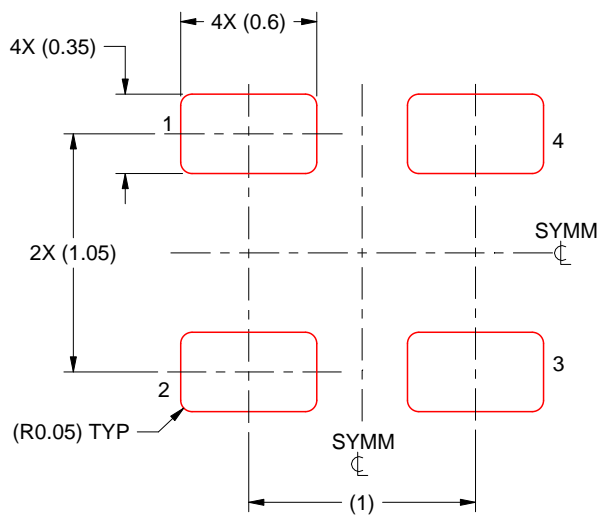
4. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

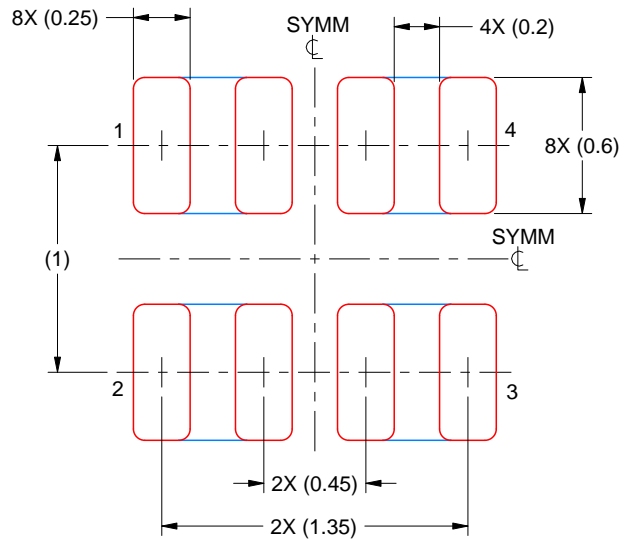
DLY0004C

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 30X



UNIVERSAL SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 30X

PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
ALL PADS: 71%

4229829/B 08/2025

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

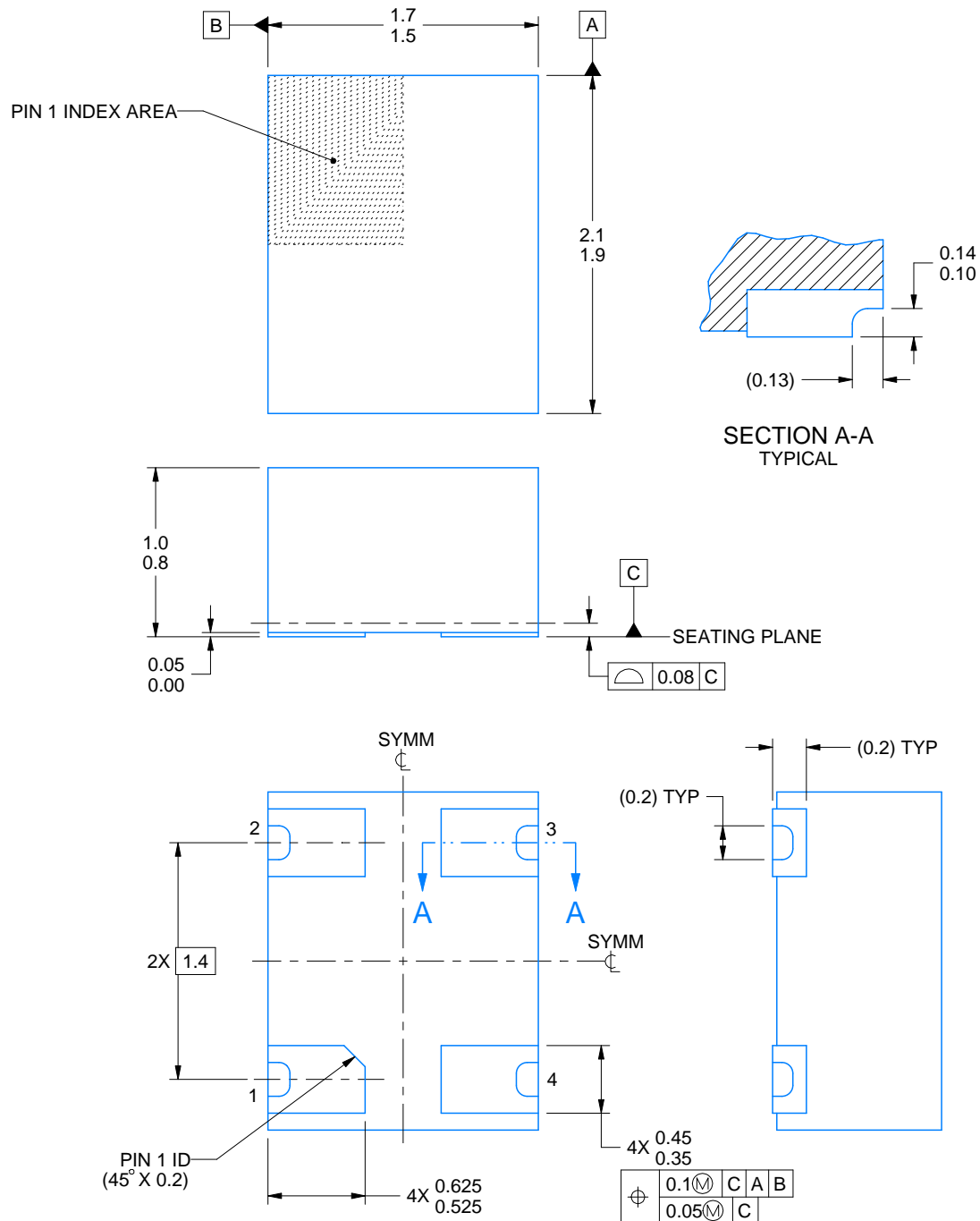
DLR0004A



PACKAGE OUTLINE

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



4230546/B 08/2025

NOTES:

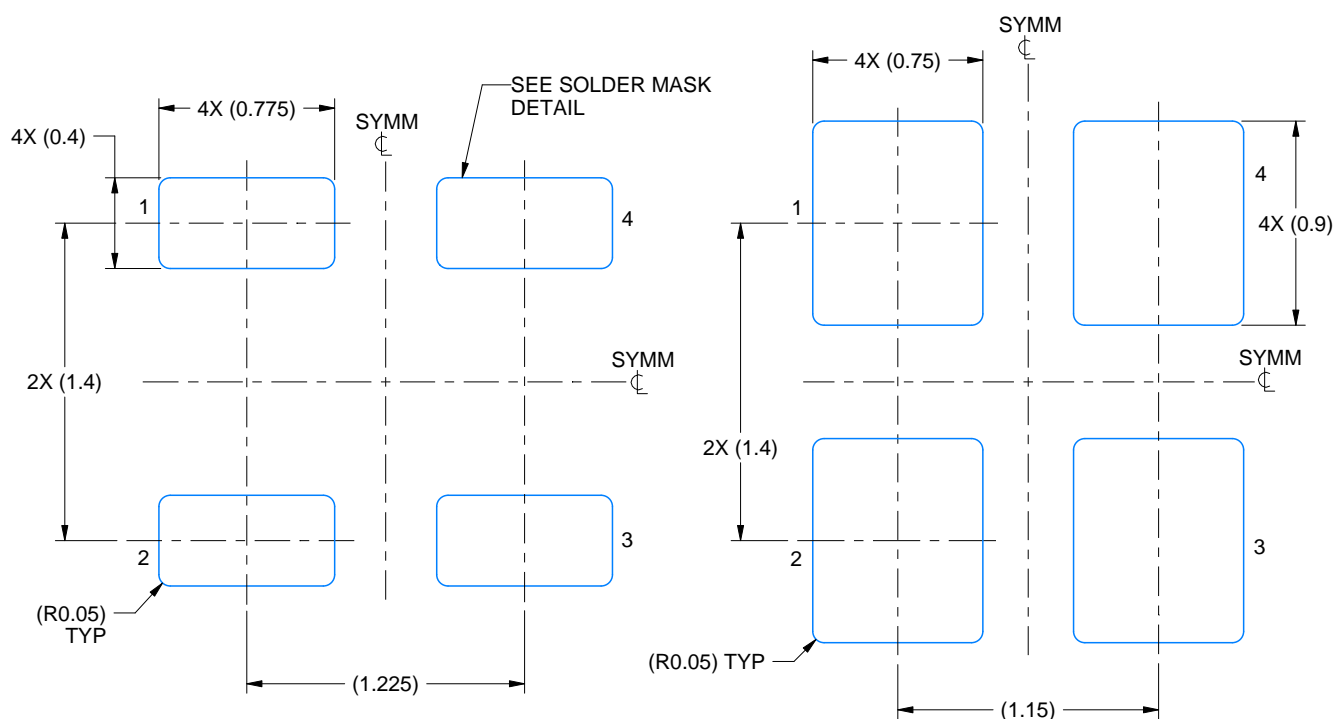
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DLR0004A

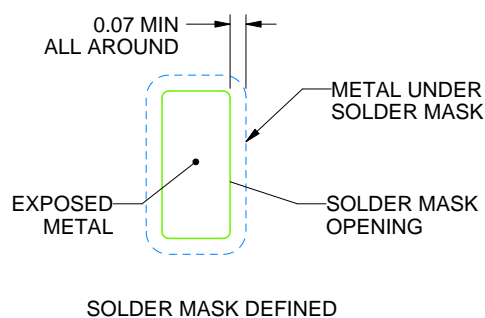
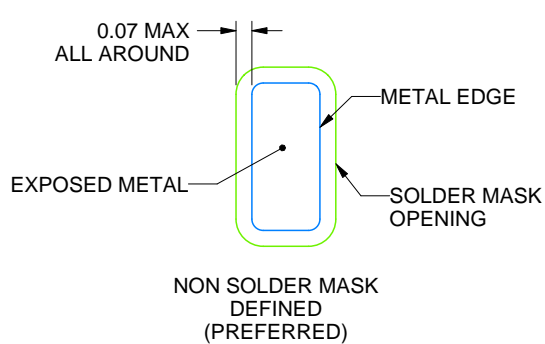
VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 30X

UNIVERSAL LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 30X



SOLDER MASK DETAILS

4230546/B 08/2025

NOTES: (continued)

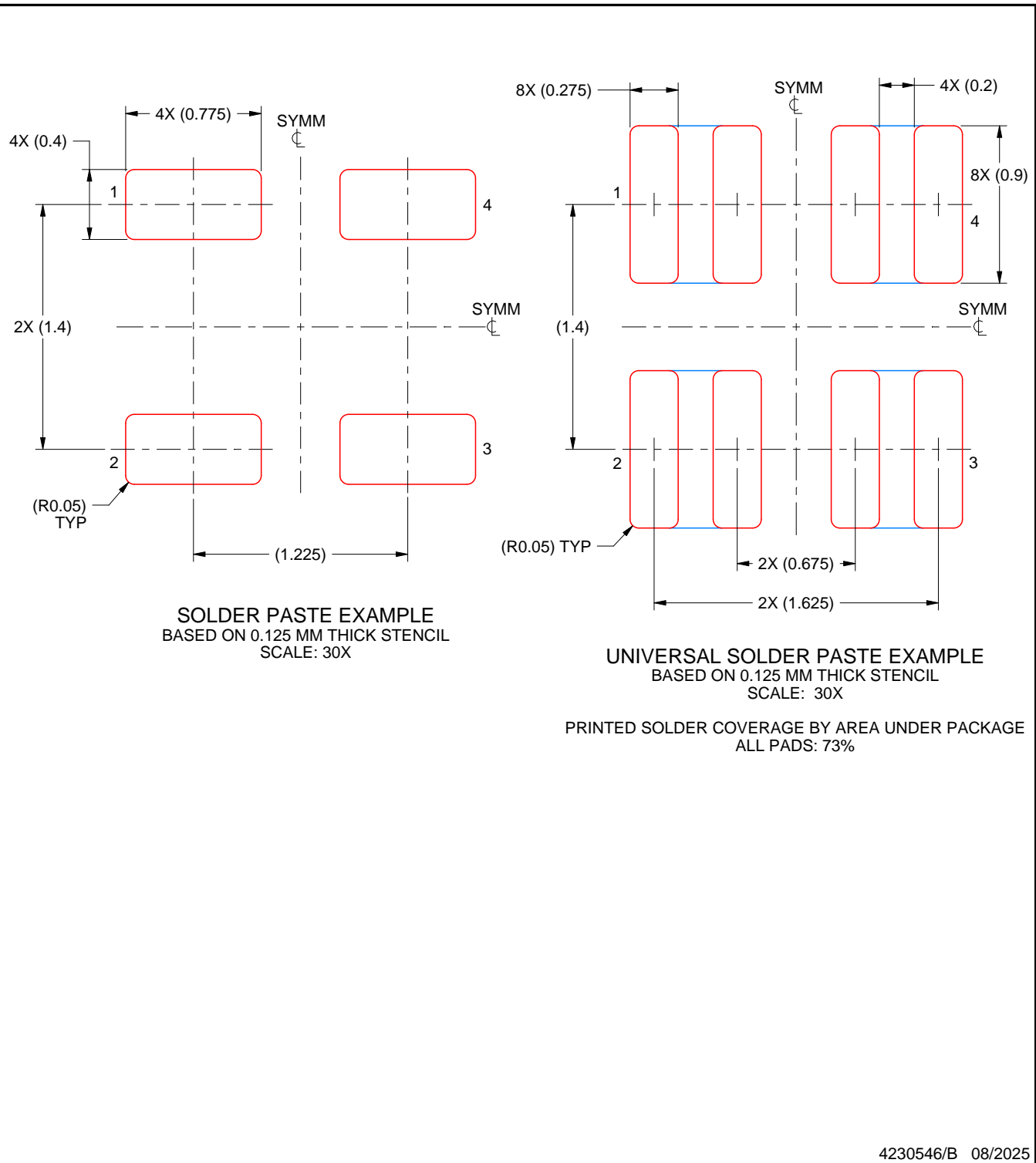
4. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DLR0004A

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

GENERIC PACKAGE VIEW

DLF 4

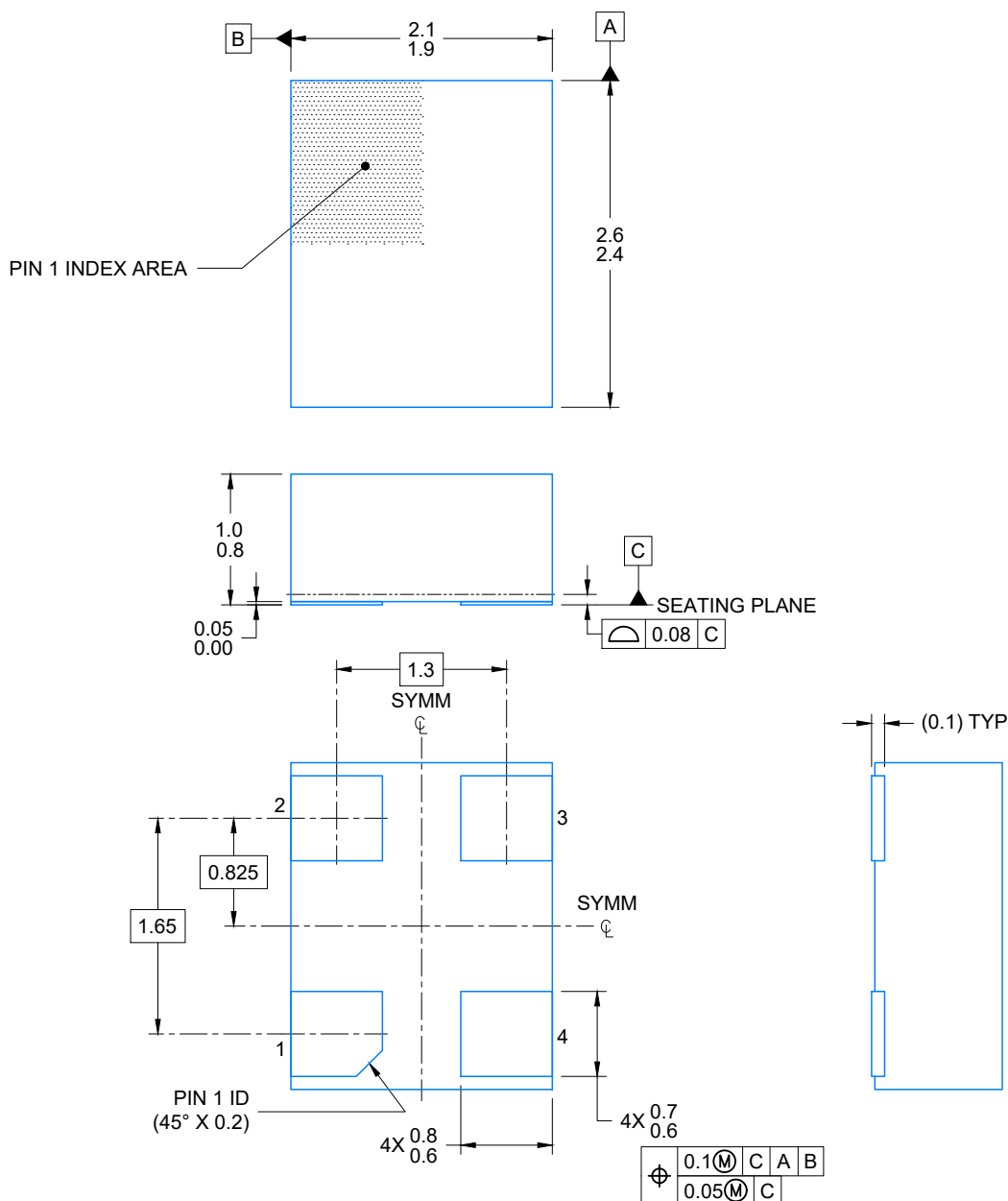
VSON - 1 mm max height

2 x 2.5, 1.65 mm pitch

PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

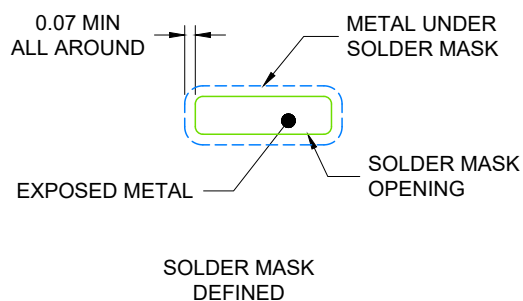
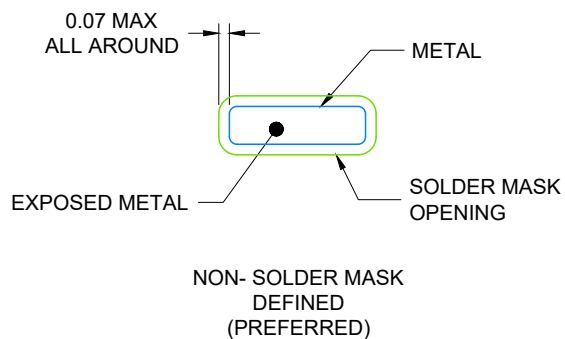
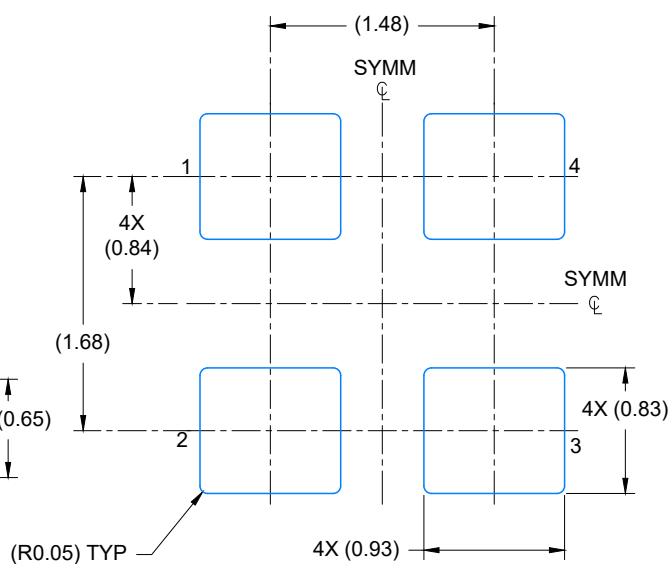
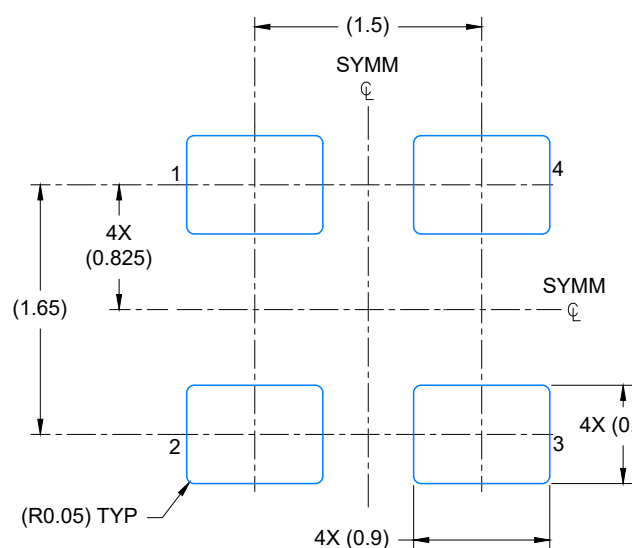




4225946/E 08/2025

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

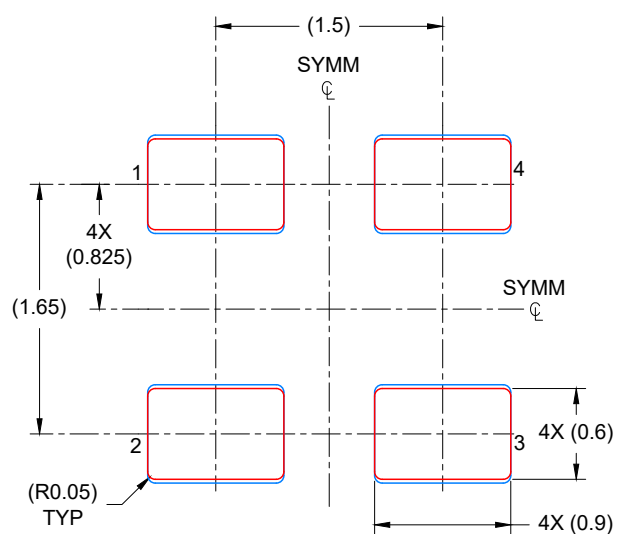


SOLDER MASK DETAILS

4225946/E 08/2025

NOTES: (continued)

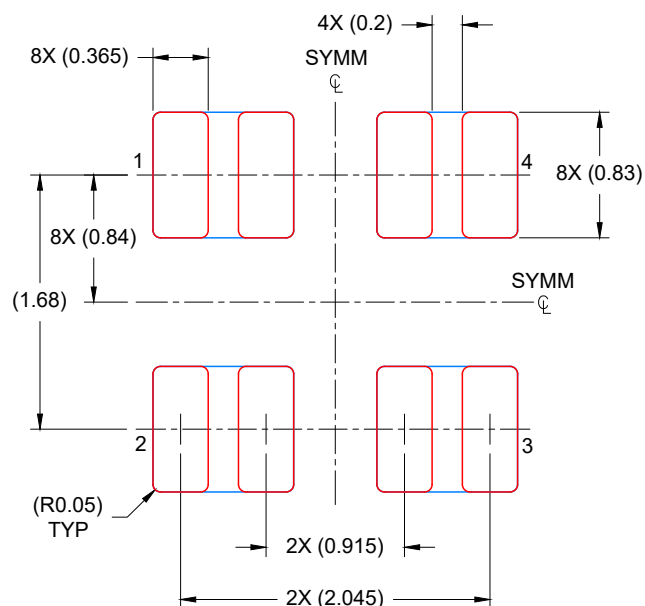
- For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271) .



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

ALL PADS: 92%
SCALE: 20X



UNIVERSAL SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

ALL PADS: 78%
SCALE: 20X

4225946/E 08/2025

NOTES: (continued)

4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

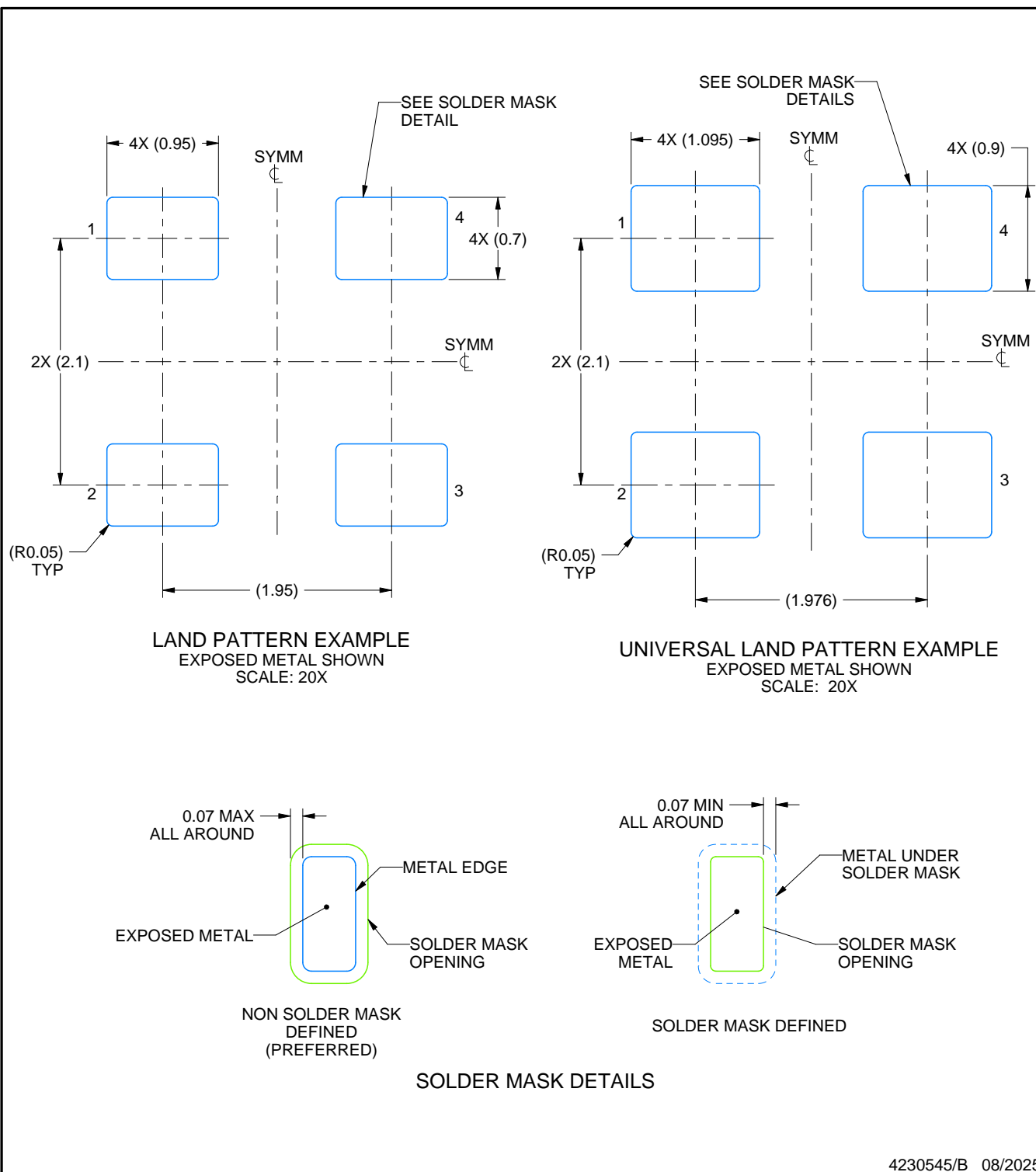
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.

2. This drawing is subject to change without notice.

DLN0004A

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



NOTES: (continued)

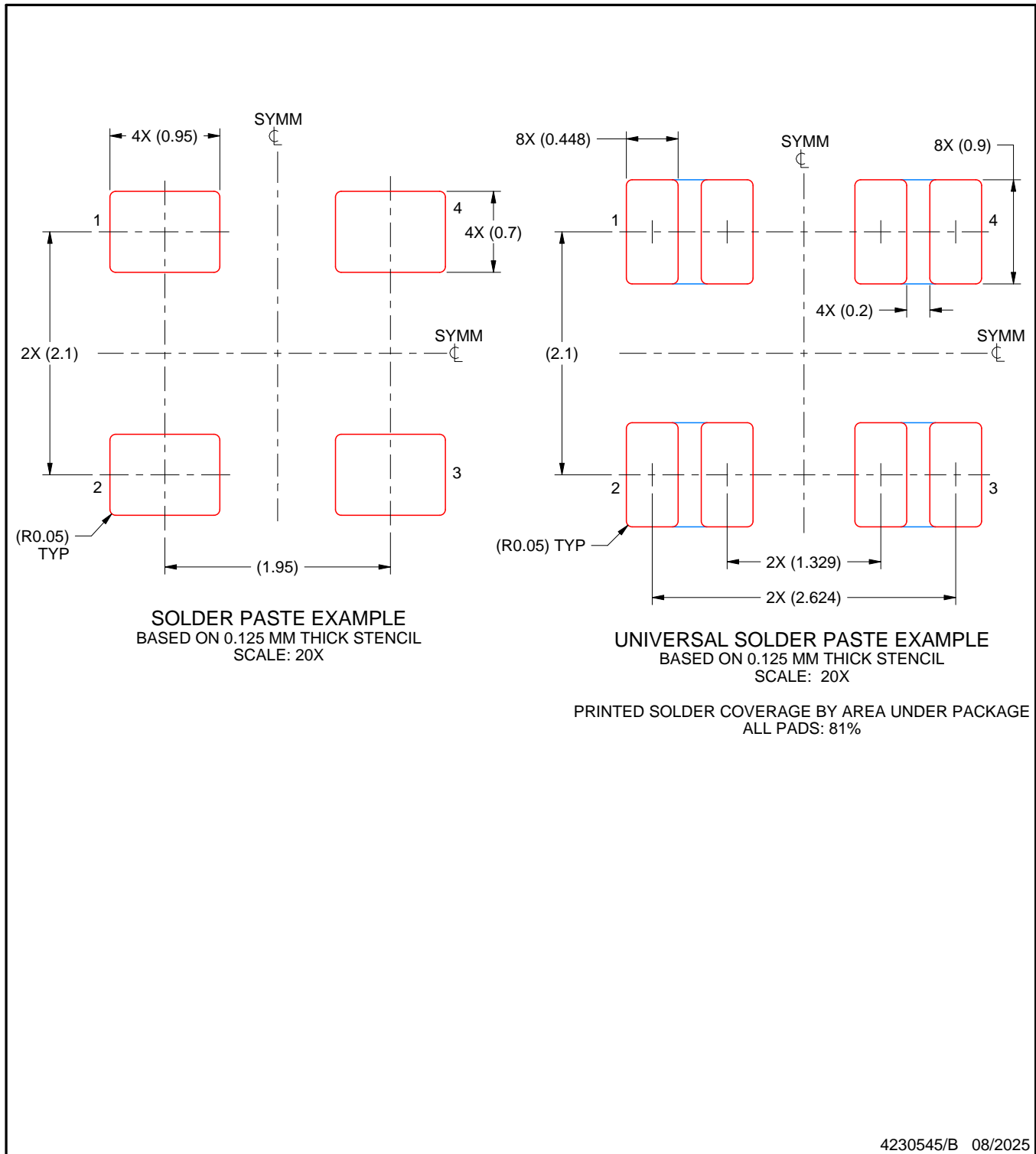
4. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sl原因271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DLN0004A

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月